

文档全称	YM310 B09&B19 CAT1 模块硬件使用指南
版本	V1.1
页数	65
日期	2026/1/30

# YM310 B09&B19 CAT1 模块硬件使用指南

---

V1.1



Shanghai YUGE Information Technology co., LTD

All rights reserved

## 修订历史

文档版本	发布日期	更改说明	作者
V1.0	2026/1/30	初稿	Tony Liu

# 目 录

第 1 章 引言 .....	10
第 2 章 模块综述 .....	11
2.1 模块简介 .....	11
2.2 模块特性 .....	11
2.3 模块功能 .....	14
第 3 章 接口应用描述 .....	15
3.1 本章概述 .....	15
3.2 模块接口 .....	16
3.2.1 模块管脚分布图 .....	16
3.2.2 管脚定义 .....	17
3.3 电源接口 .....	23
3.3.1 电源设计 .....	23
3.3.2 电源参考电路 .....	24
3.3.3 VDD_EXT 电压输出 .....	25
3.4 复位控制 .....	25
3.5 模块开机 .....	27
3.6 模块关机 .....	29
3.7 强制下载 .....	30
3.8 USB 接口 .....	30
3.9 UART 接口 .....	31
3.9.1 主串口 .....	32
3.9.2 调试串口 .....	33
3.10 休眠唤醒 .....	33
3.10.1 UART 接口通信方式 .....	34
3.10.2 USB 接口通信方式 .....	34
3.10.2.1 支持 USB 挂起与唤醒及 USB 远程唤醒功能 .....	34
3.10.2.2 支持 USB 挂起与唤醒及 RI 信号唤醒功能 .....	35
3.10.2.3 不支持 USB 挂起,模块休眠和唤醒功能 .....	35
3.11 USIM 接口 .....	36
3.12 状态指令接口 .....	37

3.13 I2C 总线 .....	38
3.14 PCM 语音接口 .....	39
3.15 模拟语音接口 .....	40
3.16 LCD 接口 .....	41
3.17 Camera 接口 .....	42
3.18 矩阵键盘接口 .....	42
3.19 ADC 接口 .....	43
3.20 射频接口 .....	44
3.20.1 天线匹配电路 .....	44
3.20.2 射频走线参考 .....	45
<b>第 4 章 总体技术指标 .....</b>	<b>46</b>
4.1 本章概述 .....	46
4.2 工作频率 .....	46
4.3 射频传导测量 .....	47
4.3.1 测试环境 .....	47
4.3.2 测试标准 .....	47
4.4 传导接收灵敏度和发射功率 .....	47
4.5 天线要求 .....	48
4.6 功耗特性 .....	49
<b>第 5 章 接口电气特性 .....</b>	<b>52</b>
5.1 本章概述 .....	52
5.2 工作存储温度 .....	52
5.3 模块 IO 电平 .....	52
5.4 电源特性 .....	52
5.5 静电特性 .....	53
5.6 可靠性指标 .....	53
<b>第 6 章 结构及机械特性 .....</b>	<b>55</b>
6.1 本章概述 .....	55
6.2 外观 .....	55
6.3 机械尺寸 .....	56
<b>第 7 章 包装与生产 .....</b>	<b>59</b>
7.1 本章概述 .....	59

---

7.2 模块包装与存储.....	59
7.3 生产焊接.....	59
<b>第 8 章 附录.....</b>	<b>61</b>
8.1 本章概述.....	61
8.2 缩略语.....	61
8.3 编码方式.....	62
8.4 使用安全与注意事项.....	65

## 图片索引

图 2-1 YM310 B09&B19 模块功能框图 .....	14
图 3-1 YM310 B09&B19 模块管脚分布图 (TOP 透视) .....	16
图 3-2 供电电源设计 .....	24
图 3-3 LDO 线性电源参考电路 .....	24
图 3-4 DC 开关电源参考电路 .....	24
图 3-5 PMOS 管控制电源开关参考电路 .....	25
图 3-6 复位参考电路 .....	26
图 3-7 复位时序图 .....	27
图 3-8 开机时序图 .....	28
图 3-9 开集驱动开机参考电路 .....	29
图 3-10 按键开机参考电路 .....	29
图 3-11 关机时序图 .....	30
图 3-12 USB 连接设计电路图 .....	31
图 3-13 串口设计图 .....	32
图 3-14 电平转换芯片电路 .....	33
图 3-15A UART 接口休眠唤醒硬件连接图 .....	34
图 3-15B 支持 USB 远程唤醒功能硬件连接图 .....	34
图 3-15C 支持 MAIN_RI 唤醒功能硬件连接图 .....	35
图 3-15D 不支持 USB 挂起功能硬件连接图 .....	36
图 3-16 USIM 设计电路图 .....	37
图 3-17 网络状态指示灯电路图 .....	38
图 3-18 I2C 接口参考电路图 .....	39
图 3-19 PCM 短帧模式时序图 .....	40
图 3-20 PCM 音频参考电路 .....	40
图 3-21 模拟语音电路图 .....	41

图 3-22 矩阵键盘参考电路 .....	43
图 3-23 天线匹配电路 .....	44
图 3-24 微带线的完整结构 .....	45
图 3-25 带状线的完整结构 .....	45
图 3-26 参考地为第三层 PCB 微带传输线结构 .....	45
图 6-1 YM310 B09&B19 外观图 .....	55
图 6-2 模块正视图与侧视图(单位: 毫米) .....	56
图 6-3 模块底视图 (单位: 毫米) .....	57
图 6-4 模块推荐封装(单位: 毫米) .....	58
图 7-1 回流焊温度曲线图 .....	60

## 表格索引

表 2-1 模块频段型号列表 .....	11
表 2-2 关键特性 .....	12
表 3-1 管脚定义 .....	17
表 3-2 IO 参数定义 .....	18
表 3-3 管脚描述 .....	19
表 3-4 电源管脚定义 .....	23
表 3-5 电源设计说明 .....	24
表 3-6 复位脚定义 .....	25
表 3-7 复位方式 .....	26
表 3-8 RESET 引脚参数 .....	26
表 3-9 开关机管脚定义 .....	27
表 3-10 开机时序参数 .....	28
表 3-11 模块关机方式 .....	30
表 3-12 USB_BOOT 接口管脚定义 .....	30
表 3-13 USB 接口管脚定义 .....	31
表 3-14 主串口信号定义 .....	32
表 3-15 辅助串口接口定义 .....	32
表 3-16 调试串口管脚定义 .....	33
表 3-17 SIM 卡信号定义 .....	36
表 3-18 状态指示管脚定义 .....	37
表 3-19 模块运行状态指示 .....	38
表 3-20 模块网络状态指示 .....	38
表 3-21 I2C 管脚定义 .....	38
表 3-22 PCM 管脚定义 .....	39
表 3-23 AUDIO 管脚定义 .....	41

表 3-24 LCD 接口管脚定义 .....	42
表 3-25 Camera 接口管脚定义 .....	42
表 3-26 键盘接口管脚定义 .....	42
表 3-27 ADC 管脚定义 .....	43
表 3-28 天线接口管脚定义 .....	44
表 4-1 LTE 频率表 .....	46
表 4-2 测试仪器 .....	47
表 4-3 LTE 射频灵敏度指标 .....	47
表 4-4 LTE 射频发射功率指标 .....	48
表 4-5 天线指标要求 .....	48
表 4-6 休眠空闲功耗 .....	49
表 4-7 LTE 数据传输功耗 .....	49
表 5-1 YM310 B09&B19 模块工作存储温度 .....	52
表 5-2 YM310 B09&B19 模块电气特性 .....	52
表 5-3 YM310 B09&B19 模块工作电压 .....	52
表 5-4 YM310 B09&B19 ESD 特性 .....	53
表 5-5 YM310 B09&B19 可靠性测试 .....	53
表 7-1 回流工艺参数表 .....	60
表 8-1 术语缩写 .....	61
表 8-2 GPRS/EDGE 不同等级的时隙分配表 .....	62
表 8-3 GPRS 最大速率 .....	63
表 8-4 EDGE 最大速率 .....	63
表 8-5 LTE-FDD DL 最大速率 .....	63
表 8-6 LTE-FDD UL 最大速率 .....	64

# 第 1 章 引言

本档是无线解决方案产品 YM310 B09&B19 LGA 封装 CAT1 模块硬件接口手册，旨在描述该模块方案产品的硬件组成及功能特点、应用接口定义及使用说明，电气性能和机械特性等。结合本档和其他应用文档，用户可以快速使用该模块来设计无线应用方案。

## 第 2 章 模块综述

### 2.1 模块简介

YM310 B09&B19 是一款基于 ASR1606 平台开发的小尺寸，高性能，超低功耗的 CAT1 数据传输模组。模组支持 LTE-FDD 和 LTE-TDD 网络数据连接通信协议，支持 3GPP R13 CAT1，支持 VOLTE 功能和语音服务，支持 WiFi SCAN 功能。

YM310 B09&B19 设计为片式模组，采用 LGA 贴片封装，共有 109 个引脚。模组尺寸只有  $(17.7\pm 0.1)\text{mm} \times (15.8\pm 0.1)\text{mm} \times (2.3\pm 0.15)\text{mm}$ 。YM310 B09&B19 小身材，大应用，其和主流的 GSM 和 NB-IOT 模组尺寸相同，能满足几乎所有 M2M 应用需求。

YM310 B09&B19 模块可以应用在以下场合：

- ✧ 自动化领域
- ✧ 智能计算
- ✧ 跟踪系统
- ✧ 安防系统
- ✧ 户外位置
- ✧ 无线 POS 机
- ✧ 移动计算设备
- ✧ 共享单车、云喇叭等

### 2.2 模块特性

表2-1模块频段型号列表

型号	频段	芯片 (RAM+Flash)
YM310 B09ACNLX	中国/印度	4MB+2MB
YM310 B09ACNCX	TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41	4MB+4MB
YM310 B09ACNSX	FDD LTE: B1/B3/B5/B8	8MB+8MB
YM310 B19AEULX	欧/澳洲	4MB+2MB
YM310 B19AEUCX	TDD LTE: B38/B40/B41	4MB+4MB
YM310 B19AEUSX	FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28	8MB+8MB
YM310 B19ANALX	北美	4MB+2MB
YM310 B19ANACX	TDD LTE: B38/B40/B41	4MB+4MB

YM310 B19ANASX	FDD LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66	8MB+8MB
----------------	-----------------------------------	---------

表2-2 关键特性

特性		描述
物理特性		(17.7±0.1)mm * (15.8±0.1)mm * (2.3±0.15)mm
固定方式		LGA 封装, 贴片固定
工作电压		3.3V ~ 4.2V 典型电压 3.7V
省电电流		1.23mA@休眠 (DRX=2.56s) 1.52mA@休眠 (DRX=0.64s)
应用接口	USIM 接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持两组 USIM 卡, 均支持 3.0V 和 1.8V</li> <li>◇ USIM1 支持热插拔功能</li> </ul>
	USB 接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 符合 USB2.0 规范 (仅支持从模式), 数据传输速率最大到 480Mbps</li> <li>◇ 用于 AT 命令、数据传输、软件调试和软件升级</li> <li>◇ USB 驱动支持 Windows/Linux/Android 等</li> </ul>
	UART 接口	主串口(4 线): <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 用于 AT 命令和数据传输</li> <li>◇ 支持 RTS 和 CTS 硬件流控</li> <li>◇ 波特率最高支持 3.6Mbps, 默认为 115200bps</li> </ul> 辅助串口(2 线): <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 用于与外设通讯</li> <li>◇ 默认波特率为 115200bps</li> </ul> 调试串口(2 线): <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 用于调试信息输出, 打印模块日志</li> <li>◇ 默认波特率为 115200bps</li> </ul>
	I2C 接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 符合 I2C 总线协议</li> <li>◇ 高速模式最高可支持 3.4Mbps 速率</li> </ul>
	PCM 接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持一组 PCM 数字语音, 实现和外部 DAC 或 CODEC 器件的音频输出</li> <li>◇ 支持 16 位线性编码格式</li> <li>◇ 支持短帧模式, 模块仅做主设备</li> </ul>
	模拟音频	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持一组模拟音频输入接口</li> <li>◇ 支持一组模拟音频输出接口</li> </ul>

	LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持最大分辨率为 240*320</li> <li>◇ 支持 SPI 4 线单数据线传输</li> </ul>
	Camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持最大 0.3MP 像素，不支持摄像模式</li> <li>◇ 支持 SPI 单数据线或双数据线传输</li> </ul>
	ADC 接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持 2 路 12 位采样 ADC</li> <li>◇ 电压输入范围 0~1.2V</li> </ul>
	状态指示	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ NET_STATUS 网络运行状态指示</li> <li>◇ STATUS 模块运行状态指示</li> </ul>
	BOOT	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 1 路强制下载接口</li> </ul>
LTE 发射功率		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ LTE: Class 3(23dBm±2dB)</li> </ul>
LTE 特性		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ LTE: DL 10Mbps, UL 5Mbps@20M</li> <li>◇ 支持 3GPP Rel-13 Cat1 bis FDD 和 TDD</li> <li>◇ 支持 1.4/3/5/10/15/20MHz 射频带宽</li> <li>◇ 上行调制方式: QPSK、16QAM</li> <li>◇ 下行调制方式: QPSK、16PAM 和 64QAM</li> </ul>
SMS		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 文本与 PDU 模式</li> <li>◇ 点对点短信收发</li> <li>◇ 短消息小区广播</li> <li>◇ 短消息存储: 存储在 USIM 卡和 ME 中，默认在 ME 中</li> </ul>
WiFi Scan		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持 WIFI Scan 定位(共用主天线，时分复用)</li> </ul>
AT 指令		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持标准 AT 指令集(Hayes 3GPP TS 27.007 和 27.005)</li> <li>◇ 具体查询 AT 指令集</li> </ul>
网络协议		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持 TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/CMUX/RNDIS/NTP/HTTPS/PING 协议</li> </ul>
天线接口		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ ANT_MAIN *1, 特征阻抗 50Ω</li> </ul>
虚拟网卡		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 支持 USB 虚拟网卡</li> </ul>
温度范围		<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 正常工作温度-30℃ to + 75℃</li> <li>◇ 极限工作温度-40℃ to + 85℃</li> <li>◇ 存储温度-40℃ to + 90℃</li> </ul>

 **NOTE**

- ◇ 当温度在 -40℃~-30℃或+75℃~+85℃范围时，模块个别射频指标可能会略微超出 3GPP 标准范围。模块仍能保持正常工作状态，射频频谱、网络基本不受

影响。当温度恢复至正常工作温度范围时，模块各项指标仍能符合 3GPP 规范要求。

## 2.3 模块功能

YM310 B09&B19 模块主要包含以下电路单元：

- ◇ LTE 射频处理单元
- ◇ 电源管理单元
- ◇ 模块接口单元
- ◇ 外围接口单元

YM310 B09&B19 模块功能框图如下所示：

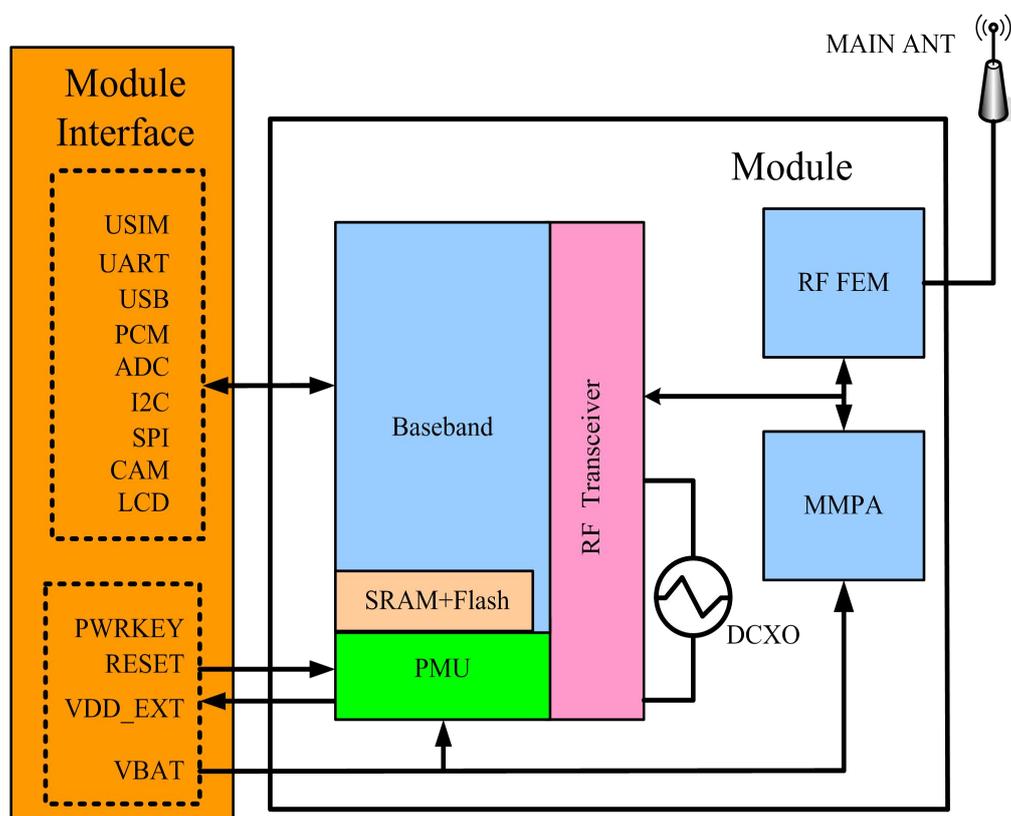


图 2-1 YM310 B09&B19 模块功能框图

## 第 3 章 接口应用描述

### 3.1 本章概述

本章主要描述该模块的接口定义和应用。包含以下几部分：

- ◇ 模块管脚分布图
- ◇ 管脚定义
- ◇ 电源接口
- ◇ USB 接口
- ◇ USIM 接口
- ◇ UART 接口
- ◇ ADC 接口
- ◇ PCM 接口
- ◇ LCD 接口
- ◇ CAM 接口
- ◇ 状态指示接口
- ◇ 射频天线接口

## 3.2 模块接口

### 3.2.1 模块管脚分布图

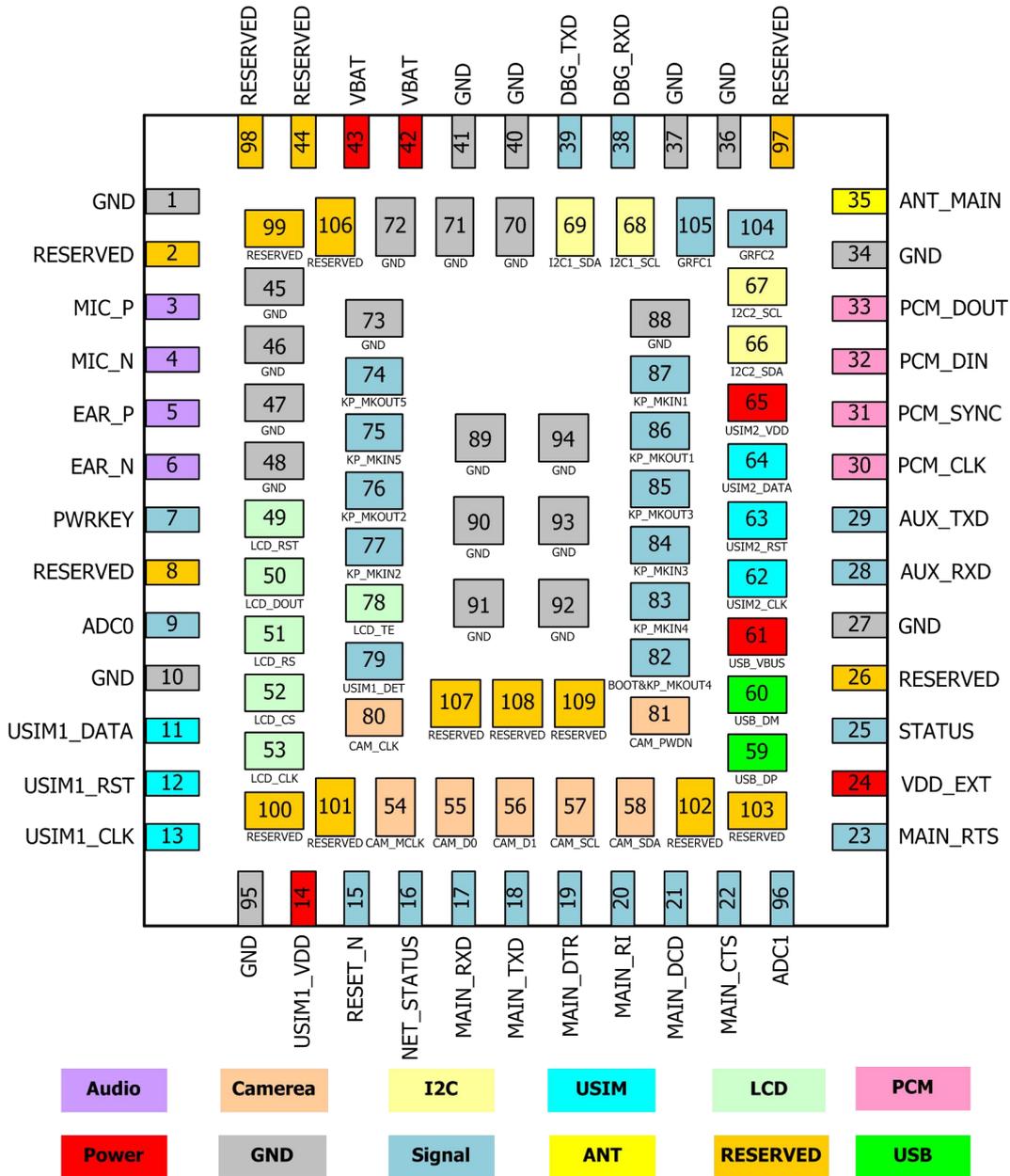


图 3-1 YM310 B09&B19 模块管脚分布图（TOP 透视）

#### NOTE

- ◇ 所有 RESERVED 和不用的 Pin 脚需悬空。
- ◇ 模块 82 Pin 脚在模块成功开机前禁止下拉到低电平。
- ◇ 为兼容 CLM920\_HV9&LV9 模块，PIN32、PIN33 管脚可通过软件分别配置为

PCM\_DIN 和 PCM\_DOUT。

### 3.2.2 管脚定义

YM310 B09&B19 模块是 LGA 接口模块，其管脚定义如下表所示：

表3-1管脚定义

序号	引脚名称	序号	引脚名称
1	GND	2	RESERVED
3	MIC_P	4	MIC_N
5	EAR_P	6	EAR_N
7	PWRKEY	8	RESERVED
9	ADC0	10	GND
11	USIM1_DATA	12	USIM1_RST
13	USIM1_CLK	14	USIM1_VDD
15	RESET_N	16	NET_STATUS
17	MAIN_RXD	18	MAIN_TXD
19	MAIN_DTR	20	MAIN_RI
21	MAIN_DCD	22	MAIN_CTS
23	MAIN_RTS	24	VDD_EXT
25	STATUS	26	RESERVED
27	GND	28	AUX_RXD
29	AUX_TXD	30	PCM_CLK
31	PCM_SYNC	32	PCM_DIN
33	PCM_DOUT	34	GND
35	ANT_MAIN	36	GND
37	GND	38	DBG_RXD
39	DBG_TXD	40	GND
41	GND	42	VBAT
43	VBAT	44	RESERVED
45	GND	46	GND
47	GND	48	GND
49	LCD_RST	50	LCD_DOUT

51	LCD_RS	52	LCD_CS
53	LCD_CLK	54	CAM_MCLK
55	CAM_D0	56	CAM_D1
57	CAM_SCL	58	CAM_SDA
59	USB_DP	60	USB_DM
61	USB_VBUS	62	USIM2_CLK
63	USIM2_RST	64	USIM2_DATA
65	USIM2_VDD	66	I2C2_SDA
67	I2C2_SCL	68	I2C1_SCL
69	I2C1_SDA	70	GND
71	GND	72	GND
73	GND	74	KP_MKOUT5
75	KP_MKIN5	76	KP_MKOUT2
77	KP_MKIN2	78	LCD_TE
79	USIM1_DET	80	CAM_CLK
81	CAM_PWDN	82	BOOT/KP_MKOUT4
83	KP_MKIN4	84	KP_MKIN3
85	KP_MKOUT3	86	KP_MKOUT1
87	KP_MKIN1	88	GND
89	GND	90	GND
91	GND	92	GND
93	GND	94	GND
95	GND	96	ADC1
97	RESERVED	98	RESERVED
99	RESERVED	100	RESERVED
101	RESERVED	102	RESERVED
103	RESERVED	104	GRFC2
105	GRFC1	106	RESERVED
107	RESERVED	108	RESERVED
109	RESERVED		

表3-2 IO参数定义

符号标志	描述
IO	双向输入输出
PI	电源输入
PO	电源输出
AI	模拟输入
AO	模拟输出
AIO	模拟输入/输出
DI	数字输入
DO	数字输出
OD	漏级开路

表3-3 管脚描述

电源				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
14	USIM1_VDD	PO	USIM1 供电电源	模块自动识别 1.8V 或 3.0V SIM 卡
65	USIM2_VDD	PO	USIM2 供电电源	模块自动识别 1.8V 或 3.0V SIM 卡
24	VDD_EXT	PO	1.8V 电压输出	可为外部 GPIO 提供上拉( $I_{max} < 50mA$ )
42, 43	VBAT	PI	模块主电源	供电电源需要提供最少 1.5A 载流电流能力
61	USB_VBUS	PI	USB 插入检测	3V~5.25V 范围
1, 10, 27, 34, 36-37, 40-41, 45-48, 70-73, 88-95			GND	
模块状态指示接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
16	NET_STATUS	DO	模块网络状态指示	1.8V 电平,不用则悬空
25	STATUS	DO	模块运行状态指示	1.8V 电平,不用则悬空
调试串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
38	DBG_RXD	DI	调试串口数据接收	1.8V 电平,不用则悬空

39	DBG_TXD	DO	调试串口数据发送	1.8V 电平,不用则悬空
<b>SIM 接口</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
11	USIM1_DATA	IO	USIM 卡 1 数据信号线	需外部上拉 4.7K 电阻
12	USIM1_RST	DO	USIM 卡 1 复位信号线	
13	USIM1_CLK	DO	USIM 卡 1 时钟信号线	
14	USIM1_VDD	PO	USIM 卡 1 供电电源	自动识别 1.8V 或 3V
62	USIM2_CLK	DO	USIM 卡 2 时钟信号线	
63	USIM2_RST	DO	USIM 卡 2 复位信号线	
64	USIM2_DATA	IO	USIM 卡 2 数据信号线	需外部上拉 4.7K 电阻
65	USIM2_VDD	PO	USIM 卡 2 供电电源	自动识别 1.8V 或 3V
79	USIM1_DET	DI	USIM1 卡热插拔检测	建议外部预留上拉电阻
<b>PCM 接口</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
30	PCM_CLK	DO	PCM 时钟脉冲	1.8V 电压域, 可外接 codec 芯片, 不用则悬空
31	PCM_SYNC	DO	PCM 帧同步信号	
32	PCM_DIN	DI	PCM 接收数据	
33	PCM_OUT	DO	PCM 发送数据	
<b>开关机与复位</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
7	PWRKEY	DI	模块开关机信号	
15	RESET_N	DI	模块复位信号	低电平有效
<b>USB_BOOT 接口</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
82	BOOT/KP_MKOU T4	DI	强制进入下载模式	低电平有效, 模块开机前禁止下拉
<b>I2C 接口</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
66	I2C2_SDA	IO	I2C2 总线数据	1.8V 电平; 需外部上拉电阻
67	I2C2_SCL	DO	I2C2 总线时钟	
68	I2C1_SCL	DO	I2C1 总线时钟	1.8V 电平; 需外部上

69	I2C1_SDA	IO	I2C1 总线数据	拉电阻
<b>ADC 接口</b>				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
9	ADC0	AI	12bits 通用模数转换	输入范围 0~1.2V
96	ADC1	AI	12bits 通用模数转换	输入范围 0~1.2V
<b>射频接口</b>				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
35	ANT_MAIN	AIO	LTE&WIFISCAN 天线	50 $\Omega$ 特性阻抗
<b>天线调谐器控制接口</b>				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
104	GRFC2	DO	通用射频控制	1.8V 电平,不用则悬空
105	GRFC1	DO	通用射频控制	
<b>主串口</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
17	MAIN_RXD	DI	主串口数据接收	1.8V 电平,不用则悬空
18	MAIN_TXD	DO	主串口数据发送	
22	MAIN_CTS	DO	DTE 清除发送	连接至 DTE 的 CTS. 1.8V 电平,不用则悬空
23	MAIN_RTS	DI	DTE 请求发送	连接至 DTE 的 RTS. 1.8V 电平,不用则悬空
<b>中断唤醒接口</b>				
19	MAIN_DTR	DI	用于主机唤醒模块	1.8V 电平,不用则悬空
20	MAIN_RI	DO	用于模块唤醒主机	1.8V 电平,不用则悬空
<b>辅助串口</b>				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
28	AUX_RXD	DI	辅助串口数据接收	1.8V,不用则悬空
29	AUX_TXD	DO	辅助串口数据发送	1.8V,不用则悬空
<b>USB 接口</b>				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
59	USB_DP	AIO	USB 总线差分正信号	90 $\Omega$ 差分阻抗
60	USB_DM	AIO	USB 总线差分负信号	90 $\Omega$ 差分阻抗
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测	3V~5.25V

模拟音频接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
3	MIC_P	AI	音频麦克风输入 (+)	不用则悬空
4	MIC_N	AI	音频麦克风输入 (-)	
5	EAR_P	AO	音频听筒输出 (+)	
6	EAR_N	AO	音频听筒输出 (-)	
LCD 接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
49	LCD_RST	DO	LCD 复位信号	1.8V,不用则悬空
50	LCD_DOUT	DO	SPI 数据信号	
51	LCD_RS	DO	SPI 数据或命令选择	
52	LCD_CS	DO	SPI 从设备选择	
53	LCD_CLK	DO	SPI 时钟信号	
78	LCD_TE	DI	LCD 帧同步	
Camera 接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
54	CAM_MCLK	DO	CAM 主时钟	1.8V,不用则悬空
55	CAM_D0	DIO	CAM SPI 数据位 D0	
56	CAM_D1	DIO	CAM SPI 数据位 D1	
57	CAM_SCL	OD	CAM I2C 时钟	
58	CAM_SDA	OD	CAM I2C 数据	
80	CAM_CLK	DO	CAM SPI 时钟信号	
81	CAM_PWDN	DO	CAM 下电控制	
其他接口				
管脚号	模块管脚定义	IO	功能描述	备注
2, 8, 26, 44, 97-103, 106-109			RESERVED	保持悬空

 **NOTE**

✧ 该模块一般 IO 管脚电平为 1.8V(USIM1&USIM2 相关管脚电平均支持 1.8V 和 3.0V)。

### 3.3 电源接口

YM310 B09&B19 模块电源接口包含三部分：

- ◇ VBAT 为模块工作主电源
- ◇ USIM\_VDD 为 USIM 卡供电电源
- ◇ VDD\_EXT 为 1.8V 电压输出电源

#### 3.3.1 电源设计

YM310 B09&B19 模块电源接口定义如下：

表3-4 电源管脚定义

管脚号	名称	I/O	描述	最小值	典型电压	最大值
14	USIM1_VDD	PO	SIM 卡 1 电源	0V	1.8V/2.85V	1.98/3.3V
65	USIM2_VDD	PO	SIM 卡 2 电源	0V	1.8V/2.85V	1.98/3.3V
24	VDD_EXT	PO	1.8V 电压输出		1.8V	
42, 43	VBAT	PI	模块主电源	3.3V	3.7V	4.2V

当模块在最大功率发射时，电流峰值瞬间会达到 1.5A，导致供电电源上有瞬时较大压降，极端电压过低或供电电流不足，可能会引起模块关机或重启。为减少模块工作时的电源波动，需采用低 ESR 值的稳压电容，VBAT 走线尽量短足够宽，以减小走线的等效阻抗。另为保证电源稳定，建议在电源前端加  $V_{RWM}=4.7V$ 、低钳位电压和高峰值脉冲电流  $I_{PP}$  的 TVS 管。

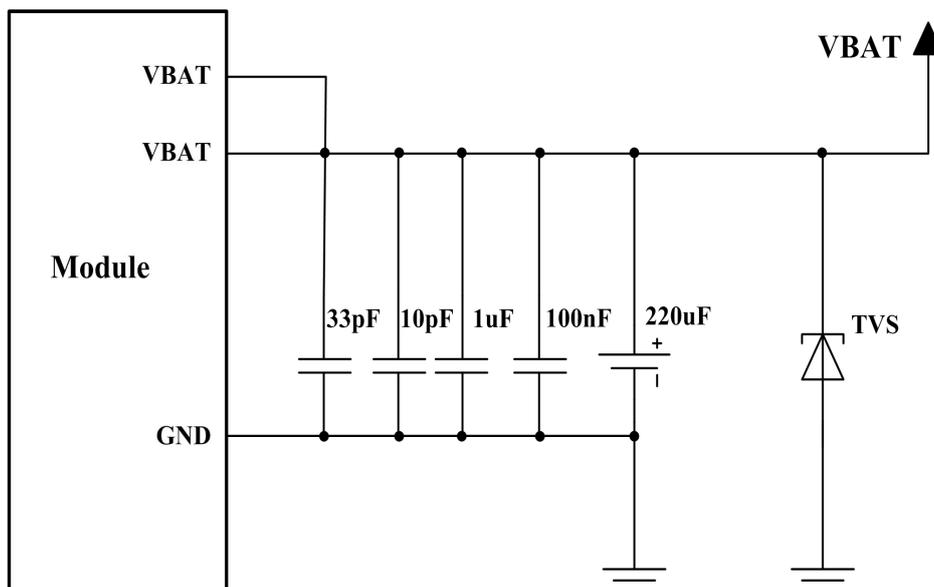


图 3-2 供电电源设计

表3-5 电源设计说明

推荐值	应用说明	备注
220uF	稳压电容	采用低 ESR 值电容，减少电源波动
WS4.5D3HV	低电容 TVS 管	避免电源浪涌或 ESD 破坏芯片
1uF, 100nF	滤波电容	滤除数字信号噪声的干扰
33pF, 10pF	滤波电容	滤除低频，中频段的射频干扰

### 3.3.2 电源参考电路

实际设计时，供电电源可使用开关 DC 电源或线性 LDO 电源来设计，再利用 PMOS 管来控制供电输入，以便能完全切断电源。两种设计电路都需拥有足够载流能力。具体参考以下电路设计：

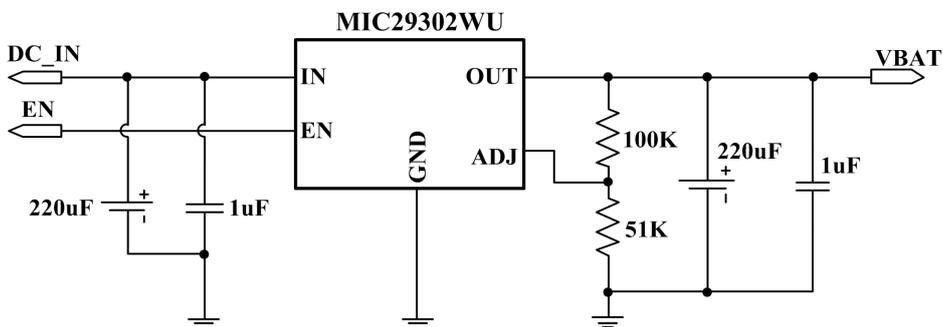


图 3-3 LDO 线性电源参考电路

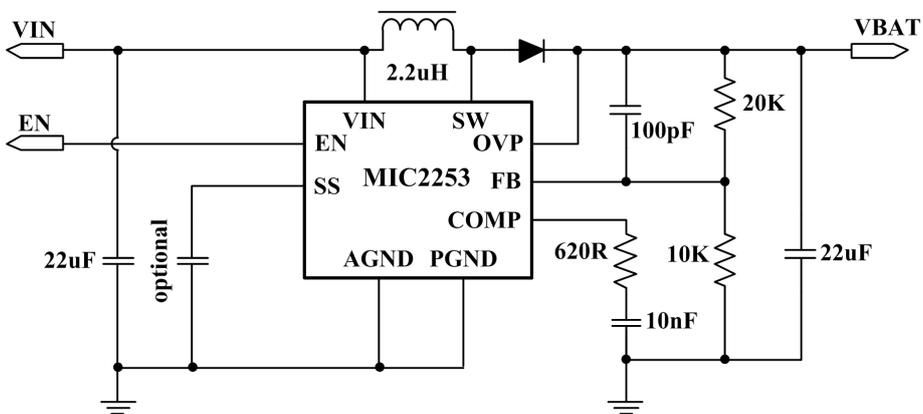


图 3-4 DC 开关电源参考电路

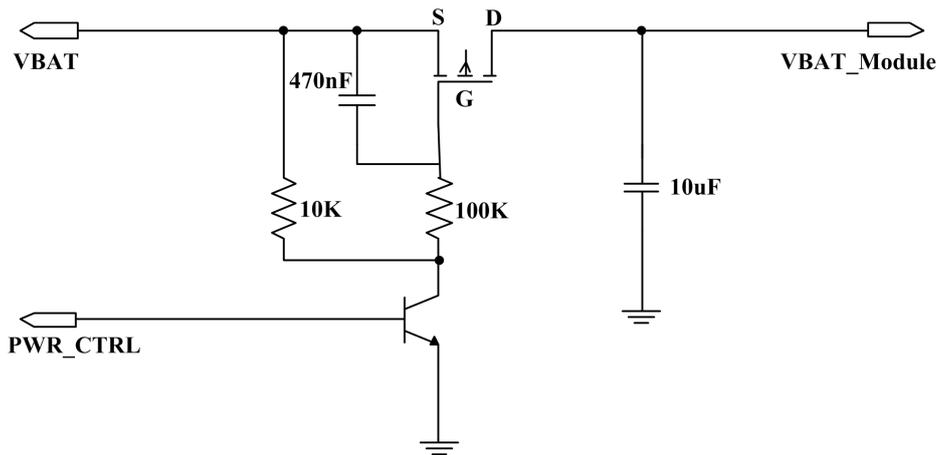


图 3-5 PMOS 管控制电源开关参考电路

### NOTE

- ✧ 模块最低工作电压为 3.3V，FDD 最大发射功率下会有约 600mA 持续性电流，故电源必须能提供足够的载流能力，否则电源电压上产生较大纹波压降，导致模块重启或工作异常。
- ✧ 由于模块电源耗流较大，建议电源 PCB 走线尽量短且足够宽，尽量减小 VBAT 走线的等效阻抗。
- ✧ 当模块处于异常状态时，建议通过断开电源关闭模块，再上电重启模块。

### 3.3.3 VDD\_EXT 电压输出

YM310 B09&B19 模块开机后会通过 Pin24 脚输出 1.8V 电压，该电压为模块的逻辑电平电压。外部主控可读取 VDD\_EXT 的电压来判断模块是否开机。该电压可供外部小电流（ $\leq 50\text{mA}$ ）电路使用。例如：电平转换芯片，GPIO 上拉等。不用则保持悬空。

## 3.4 复位控制

YM310 B09&B19 模块 Pin15 为复位管脚。应用端检测到模块异常，或软件无响应时，可以对模块进行复位，将此管脚拉低至少 300ms 即可完成复位。RESET 信号对于干扰比较敏感，可在靠近信号附近预留一个 100pF 的电容，用以滤除信号毛刺，走线时远离射频干扰信号。

表3-6 复位脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	高电平值	描述
15	RESET_N	DI	1.8V $\pm$ 0.3V	低电平有效

表3-7 复位方式

复位方式	复位方式
AT 命令复位	AT+CFUN=1,1
硬件复位	拉低 RESET_N 管脚至少 300ms 后释放可使模块复位

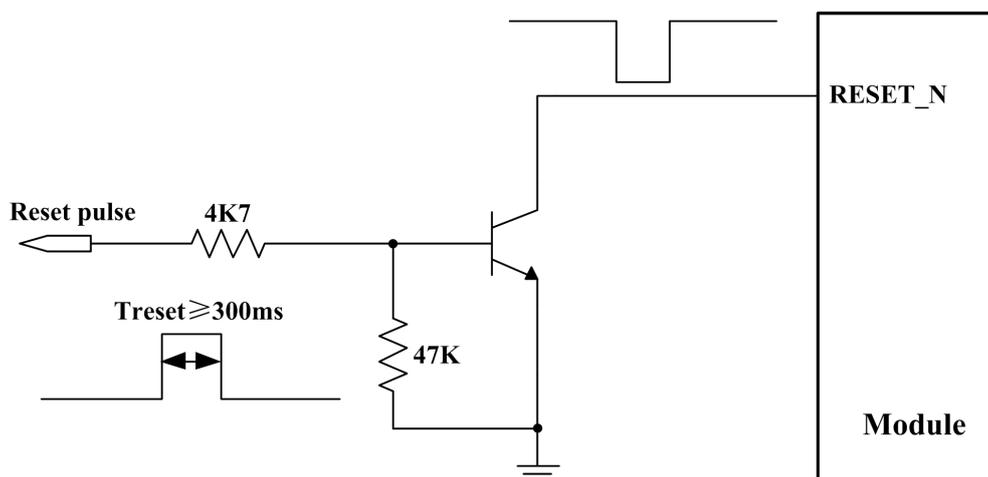


图 3-6 复位参考电路

表3-8 RESET引脚参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Treset	低电平脉冲宽度	300		-	ms
VIH	RESET 输入高电平电压		1.8	2.1	V
VIL	RESET 输入低电平电压	-0.3	0	0.8	V

RESET 时序如下：

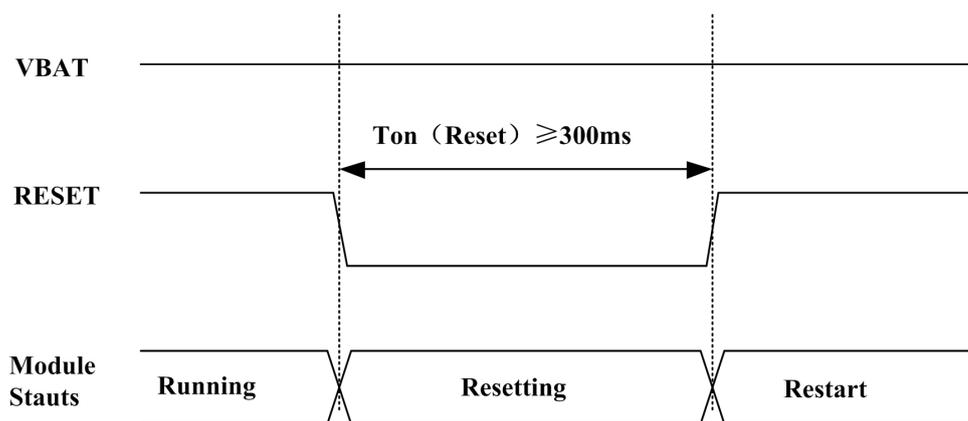


图 3-7 复位时序图

YM310 B09&B19 模块支持 AT 命令复位, AT 指令为 AT+CFUN=1,1 即可重启模块。详细指令可查看 AT 指令集手册。

### 3.5 模块开机

YM310 B09&B19 模块 Pin7 脚是开机脚, 可通过拉低模块 Pin7 脚 PWRKEY 至少 500ms 开机, 用户可通过查询 VDD\_EXT 管脚的高低电平来判断模块是否开机。

表3-9 开关机管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述	备注
7	PWRKEY	DI	开关机控制输入	低电平有效, VBAT 电压域

开机时序如下:

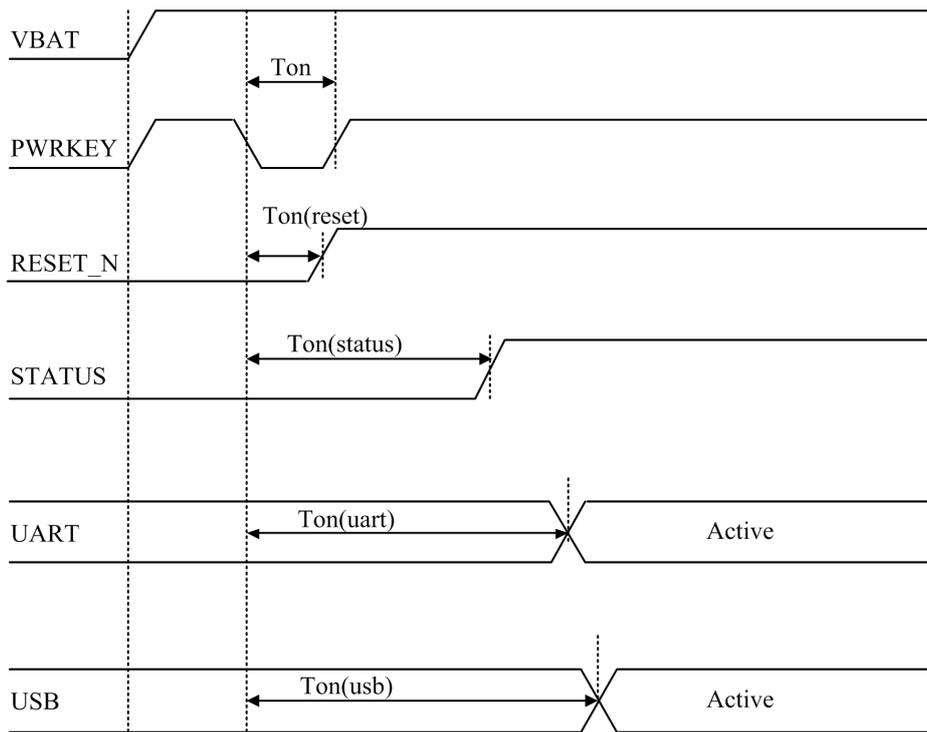


图 3-8 开机时序图

表3-10 开机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ton	开机低电平宽度	500	700	-	ms
Ton(reset)	Reset 引脚置高时间		TBD	-	s
Ton(status)	开机时间(据 status 状态判断)		TBD	-	s
Ton(uart)	开机时间(据 uart 状态判断)		TBD	-	s
Ton(usb)	开机时间(据 usb 状态判断)		TBD	-	s
VIH	PWRKEY 输入高电平	0.6	3.7	4.2	v
VIL	PWRKEY 输入低电平	-0.3	0	0.5	v

推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY，在拉高基极电平至少 500ms 后释放，此时模块开机。也可以通过按键进行开关机设计，按键附近需要放置一个 TVS 管用于 ESD 保护。

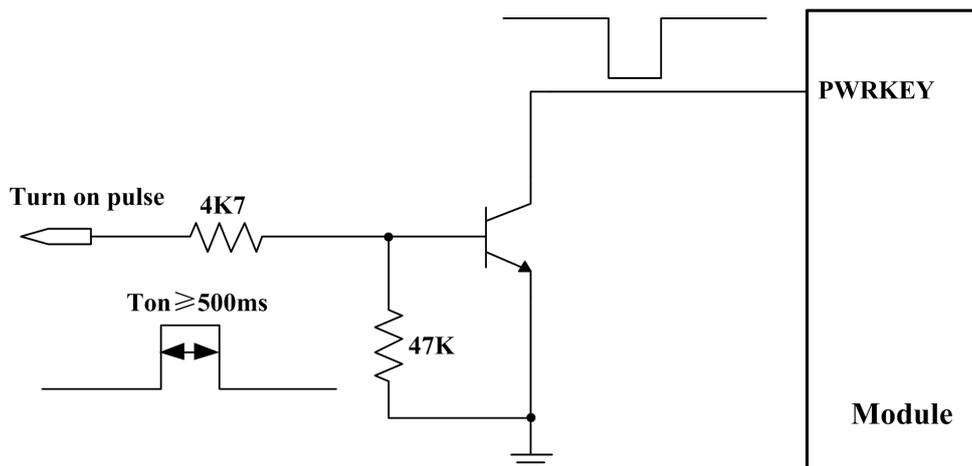


图 3-9 开集驱动开机参考电路

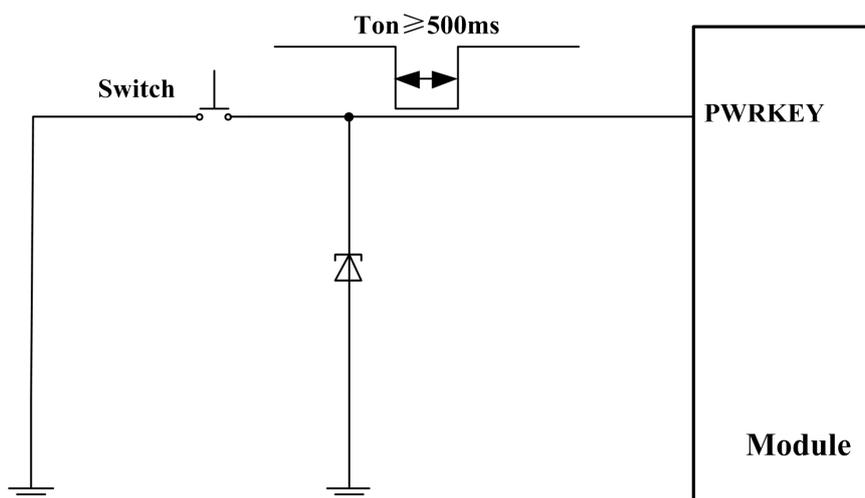


图 3-10 按键开机参考电路

### NOTE

- ✧ 模块默认为低电平开机方式。
- ✧ 可通过将模块 PWRKEY 管脚直接下拉到地实现上电自动开机方式，下拉电阻建议 4.7K  $\Omega$ 。此种开机方式不支持模块按键关机。
- ✧ 如需低脉冲开机方式，可与当地 FAE 联系获取支持。

## 3.6 模块关机

YM310 B09&B19 模块支持以下三种关机方式。

表3-11 模块关机方式

关机方式	关机条件	描述
低电压关机	供电电压过低或异常掉电	模块没有进行正常的关机流程
硬件关机	拉低 PWRKEY 管脚大于 3S	执行正常关机流程
AT 指令关机	AT 命令	软件关机

模块正常工作时，不能通过切断电源的方式来关机，有可能损坏模块 Flash 数据。建议通过开关机管脚或 AT 命令来执行关机流程。

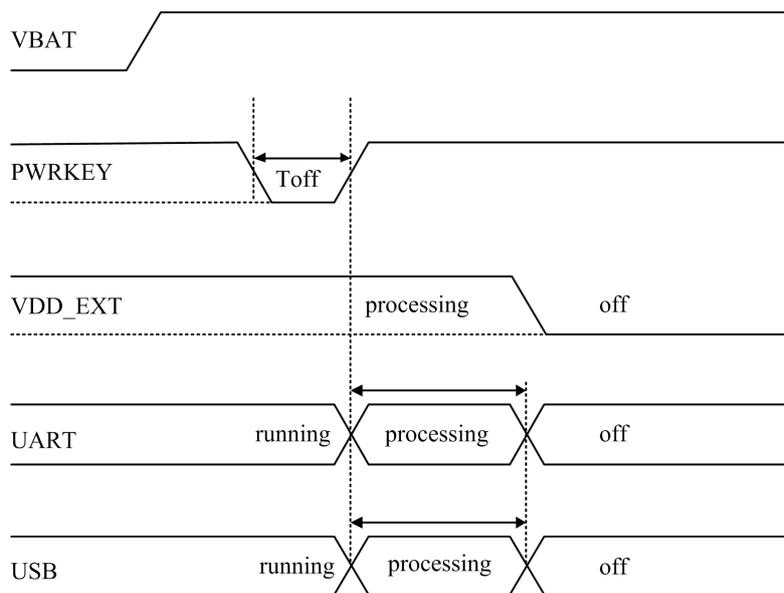


图 3-11 关机时序图

### 3.7 强制下载

YM310 B09&B19 支持 BOOT 功能。可在模块开机前将 BOOT 引脚下拉至 GND，开机时模块将进入强制下载模式，此时可通过 USB 接口对模块进行软件升级。

表3-12 USB\_BOOT接口管脚定义

管脚号	管脚定义	IO	功能描述
82	BOOT/KP_MKOUT4	DI	强制模块进入紧急下载模式

### 3.8 USB 接口

YM310 B09&B19 模块支持一路 USB2.0 接口，支持从设备模式，不支持 USB 充电

功能。USB 走线需遵从 USB2.0 协议规范，USB 接口定义如下：

表3-13 USB接口管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述
59	USB_DP	AIO	USB 总线差分正信号
60	USB_DM	AIO	USB 总线差分负信号
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测

模块作为 USB 从设备，支持 USB 休眠及唤醒机制。USB 接口应用参考电路如下：

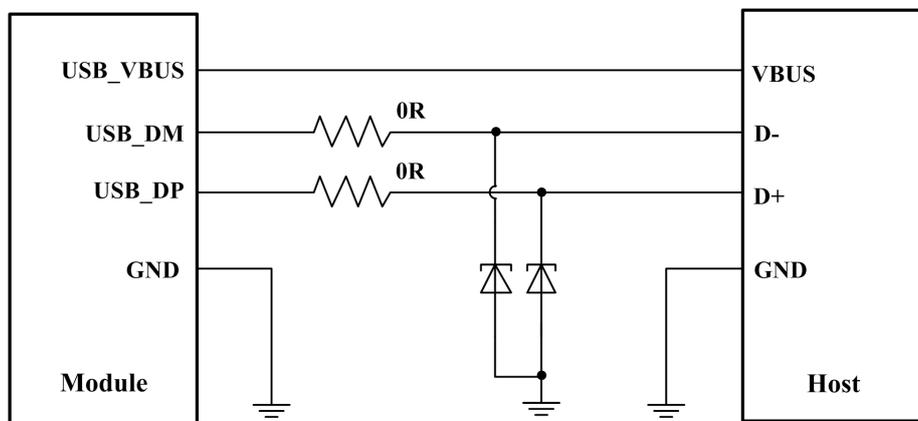


图 3-12 USB 连接设计电路图

#### NOTE

- ✧ USB 支持高速(480Mbps)和全速(12Mbps)模式，走线设计需要严格遵循 USB2.0 协议要求，注意对数据线的保护，差分走线，越短越好，尽可能远离高速信号或其他同频信号，控制阻抗为  $90\ \Omega$ 。
- ✧ 为提高 USB 接口的抗静电性能，建议数据线上增加 ESD 保护器件，保护器件的等效电容值小于  $1\text{pF}$ 。建议在数据线上串联  $0\ \Omega$  电阻。
- ✧ 模块的 USB 接口对外不提供 USB 总线电源，模块只能作为从设备。
- ✧ USB 接口支持的功能有：软件下载升级、数据通讯、AT Command 等功能。

## 3.9 UART 接口

YM310 B09&B19 模块提供三组 UART 接口。其中一组为主串口，一组为调试串口，一组为两线辅助串口。

### 3.9.1 主串口

主串口：

该串口可实现 AT 交互指令，与外设数据交互等。

模块主串口波特率可设置 9600，19200，38400，57600，115200，230400，460800，921600bps 波特率等，默认为 115200bps。

主串口接口定义如下：

表3-14 主串口信号定义

管脚号	信号名称	属性	描述
17	MAIN_RXD	DI	主串口数据接收，1.8V 电压域
18	MAIN_TXD	DO	主串口数据发送，1.8V 电压域
22	MAIN_CTS	DO	DTE 清除发送，连接至 DTE 的 RTS
23	MAIN_RTS	DI	DTE 请求发送，连接至 DTE 的 RTS

辅助串口接口定义如下：

表3-15 辅助串口接口定义

管脚号	信号名称	属性	描述
28	AUX_RXD	DI	辅助串口数据接收，1.8V 电压域
29	AUX_TXD	DO	辅助串口数据发送，1.8V 电压域

使用串口功能时，可以参考以下连接方式：

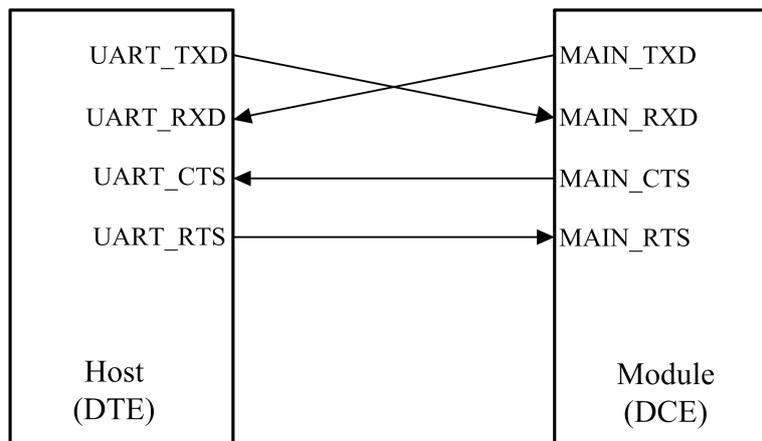


图 3-13 串口设计图

如果使用模块串口跟 3.3V 电平的 MCU 相连，因为模块串口的电平是 1.8V，则需要通过电平转换芯片来实现电平匹配，芯片连接方式可参考以下电路：

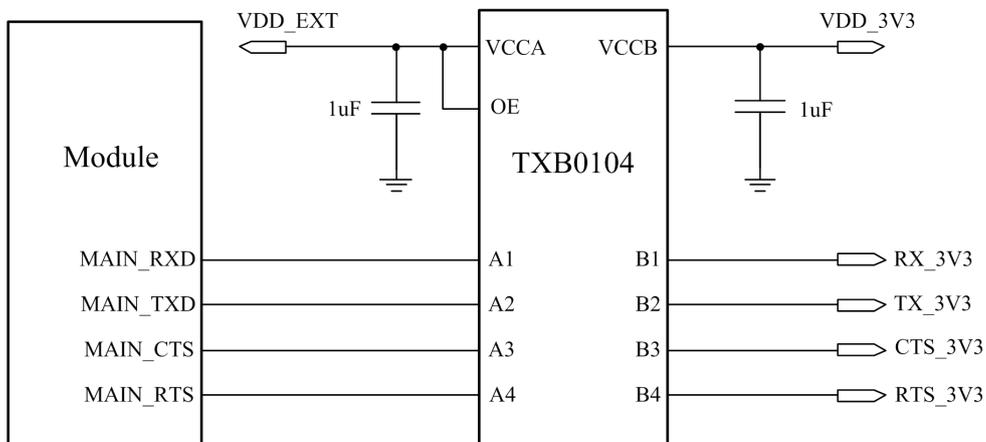


图 3-14 电平转换芯片电路

**NOTE**

- ✧ 需注意硬件流控 CTS、RTS 引脚输入输出方向。
- ✧ 对于信号传输速率不高于 115200bps 的需求，也可以使用高速晶体管。如 NPN 三极管或 NMOS 管。

### 3.9.2 调试串口

YM310 B09&B19 模块提供 2 线 Debug 串口用做调试模块，调试串口支持 115200bps 波特率，用于 Linux 控制、log 打印，可以预留测试点，不用请保持悬空。

表3-16 调试串口管脚定义

管脚号	信号名称	属性	描述	备注
38	DBG_RXD	DI	Debug 串口接收数据	仅用于 debug 调试，抓取模组 AP 侧 log
39	DBG_TXD	DO	Debug 串口发送数据	

### 3.10 休眠唤醒

YM310 B09&B19 模块支持休眠唤醒功能，通过休眠可以降低模块的功耗。休眠唤醒的方式可以通过不同的接口通信方式来实现，详见以下内容。

### 3.10.1 UART 接口通信方式

主机和模块通过 UART 接口进行通信时，其休眠与唤醒硬件连接请参考下图：

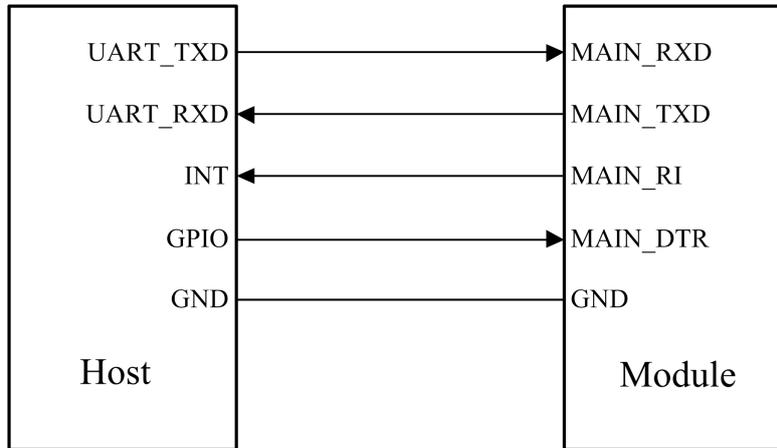


图 3-15A UART 接口休眠唤醒硬件连接图

同时满足以下两个条件：

- 1.MAIN\_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1。模块则进入休眠模式。

通过主机拉低模块的 MAIN\_DTR 来唤醒模块。当模块有 URC 需上报时，模块可以通过 MAIN\_RI 唤醒主机。

### 3.10.2 USB 接口通信方式

主机和模块通过 USB 接口进行通信时，其休眠与唤醒又可分为以下三种情况：

#### 3.10.2.1 支持 USB 挂起与唤醒及 USB 远程唤醒功能

主机支持 USB 挂起与唤醒及 USB 远程唤醒功能的硬件连接请参考下图：

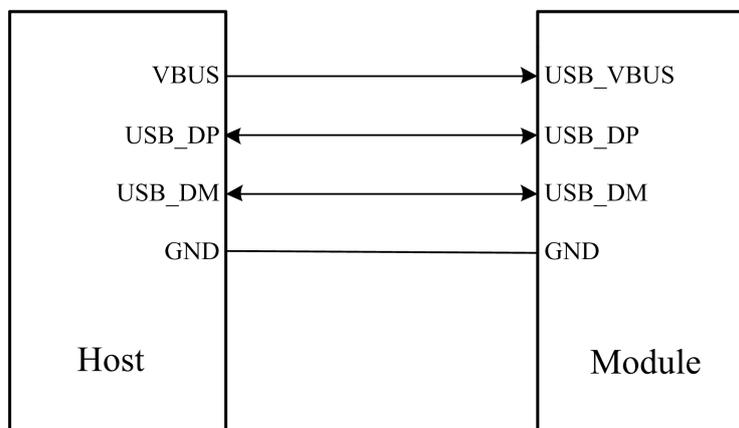


图 3-15B 支持 USB 远程唤醒功能硬件连接图

同时满足以下三个条件：

- 1.MAIN\_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1；
- 3.连接到模块 USB 接口的主机的 USB 总线进入挂起状态。模块则进入休眠模式。

主机可以通过 USB 向模块发送数据来唤醒模块，当模块有 URC 需上报时，模块可以通过 USB 总线发送远程唤醒数据来唤醒主机。

### 3.10.2.2 支持 USB 挂起与唤醒及 RI 信号唤醒功能

如果主机支持 USB 挂起与唤醒但不支持 USB 远程唤醒功能，可通过模块 MAIN\_RI 信号唤醒主机，具体硬件连接请参考下图：

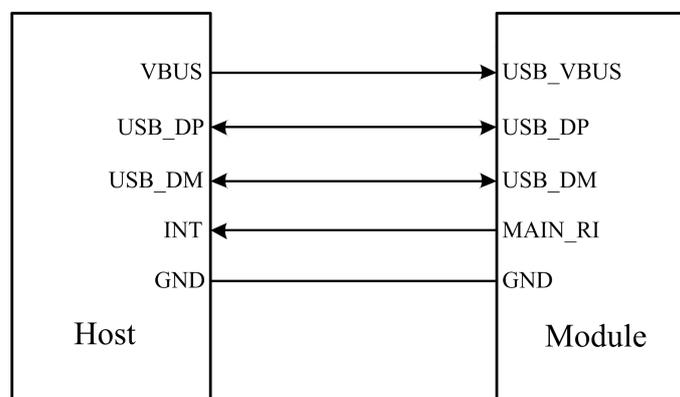


图 3-15C 支持 MAIN\_RI 唤醒功能硬件连接图

同时满足以下三个条件：

- 1.MAIN\_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1；
- 3.连接到模块 USB 接口的主机的 USB 总线进入挂起状态。模块则进入休眠模式。

主机可以通过 USB 向模块发送数据来唤醒模块，通过 AT 指令设置 MAIN\_RI 工作模式后，当模块有 URC 需上报时，模块可以先通过 MAIN\_RI 信号脚发送数据唤醒主机，主机被唤醒后再读取 URC。

### 3.10.2.3 不支持 USB 挂起,模块休眠和唤醒功能

如果主机不支持 USB 挂起，主机和模块之间的硬件连接请参考下图：

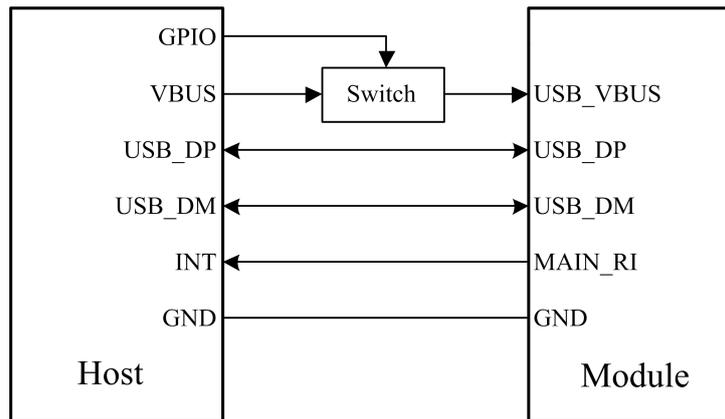


图 3-15D 不支持 USB 挂起功能硬件连接图

同时满足以下三个条件：

- 1.MAIN\_DTR 一直高电平或悬空；
- 2.执行 AT 指令：AT+CSCLK=1；
- 3.断开 USB\_VBUS 供电。模块则进入休眠模式；

主机可通过 GPIO 口控制 USB\_VBUS 供电开关,通过 USB\_VBUS 供电来唤醒模块。

### 3.11 USIM 接口

YM310 B09&B19 模块提供两个兼容 ISO 7816-3 标准的 USIM 卡接口，USIM 卡电源由模块内部电源管理器提供，USIM1&USIM2 均支持 1.8V/3.0V 的电压。

表3-17 SIM卡信号定义

管脚号	信号名称	属性	描述	备注
11	USIM1_DATA	IO	USIM 卡 1 数据信号	自适应 1.8V/3V ， USIM1_DATA 外部 4.7K 上拉至 USIM1_VDD
12	USIM1_RST	DO	USIM 卡 1 复位信号	
13	USIM1_CLK	DO	USIM 卡 1 时钟信号	
14	USIM1_VDD	PO	USIM 卡 1 供电电源	
62	USIM2_CLK	DO	USIM 卡 2 时钟信号	自适应 1.8V/3V ， USIM2_DATA 外部 4.7K 上拉至 USIM2_VDD
63	USIM2_RST	DO	USIM 卡 2 复位信号	
64	USIM2_DATA	IO	USIM 卡 2 数据信号	
65	USIM2_VDD	PO	USIM 卡 2 供电电源	
79	USIM1_DET	DI	USIM1 卡热插拔检测	

YM310 B09&B19 模块不自带 USIM 卡槽，用户使用时需在自己的接口板上设计 USIM 卡槽。USIM 卡接口参考电路如下：

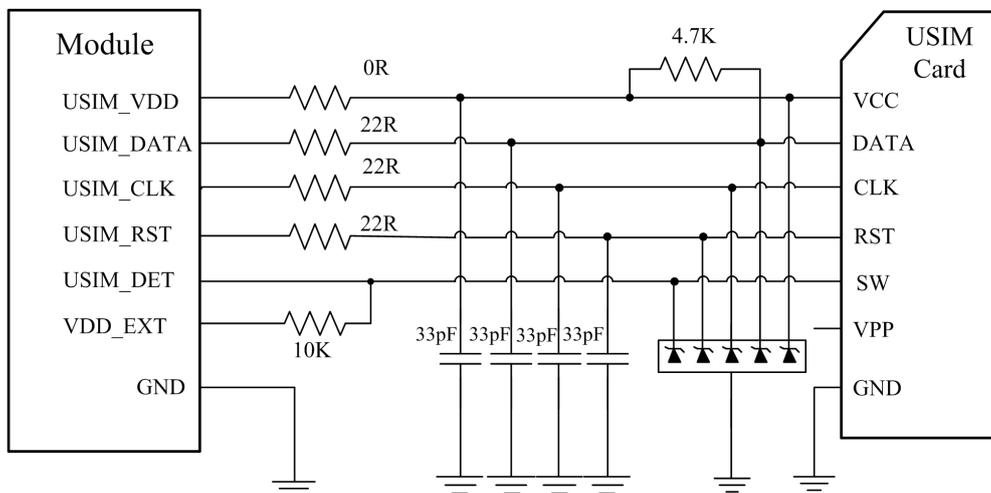


图 3-16 USIM 设计电路图

**NOTE**

- ✧ USIM 接口外围电路器件应该靠近卡座放置，USIM 卡座靠近模块布局。
- ✧ USIM 卡电路容易受到射频干扰引起不识卡或掉卡，因此卡槽应尽量放置在远离天线射频辐射的地方，卡走线尽量远离射频，电源和高速信号线。
- ✧ USIM 接口为避免瞬间电压过载，建议在信号线通路上各串联一个 22R 的电阻。
- ✧ USIM 卡座的地和模块的地要保持良好的连通性。
- ✧ USIM\_DET 管脚可以根据不同的卡座，通过 AT 命令设置检测功能，如使用常闭式 USIM 卡座时，设置 AT+HOSCFG=1,1 USIM 卡在位时状态为高；使用常开式 USIM 卡座时，设置 AT+HOSCFG=1,0 USIM 卡在位时状态为低，设置 AT+HOSCFG=0,0 SIM 卡热插拔功能关闭。
- ✧ 热插拔功能仅 USIM1 支持，USIM2 不支持。

### 3.12 状态指令接口

YM310 B09&B19 模块提供两路 GPIO 管脚来指示模块状态。

表3-18 状态指示管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述
16	NET_STATUS	DO	模块网络状态指示
25	STATUS	DO	模块运行状态指示

表3-19 模块运行状态指示

模块运行状态指示	管脚电平
开机状态	高电平
其他	低电平

表3-20 模块网络状态指示

网络运行状态指示	管脚电平
通话中	高电平
数据传输状态	快闪（125ms 高/125ms 低）
待机状态	慢闪（1800ms 高/200ms 低）
搜网状态	慢闪（200ms 高/1800ms 低）

模块网络状态指示灯参考设计图如下：

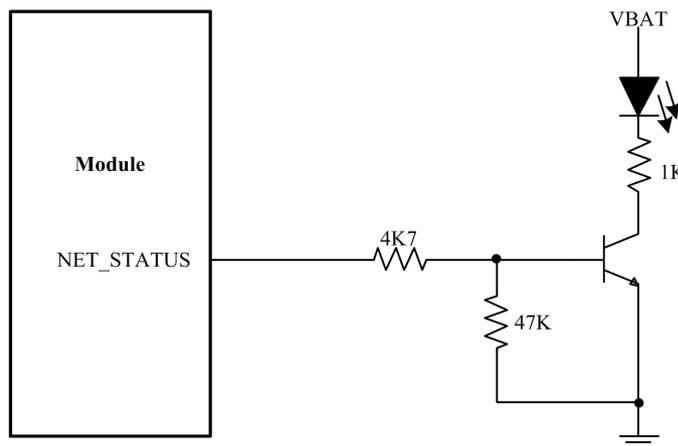


图 3-17 网络状态指示灯电路图

### NOTE

◇ 网络指示灯的亮度可通过调节限流电阻来调节。

## 3.13 I2C 总线

YM310 B09&B19 模块提供两组 I2C 接口，I2C 接口为 1.8V 电平值，5.0 协议接口，时钟速率为 400KHz。

表3-21 I2C管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述	备注
66	I2C2_SDA	IO	I2C2 总线数据	需外部上拉

67	I2C2_SCL	DO	I2C2 总线时钟	
68	I2C1_SCL	DO	I2C1 总线时钟	需外部上拉至 VDD_EXT
69	I2C1_SDA	IO	I2C1 总线数据	

I2C 参考电路接法如下：

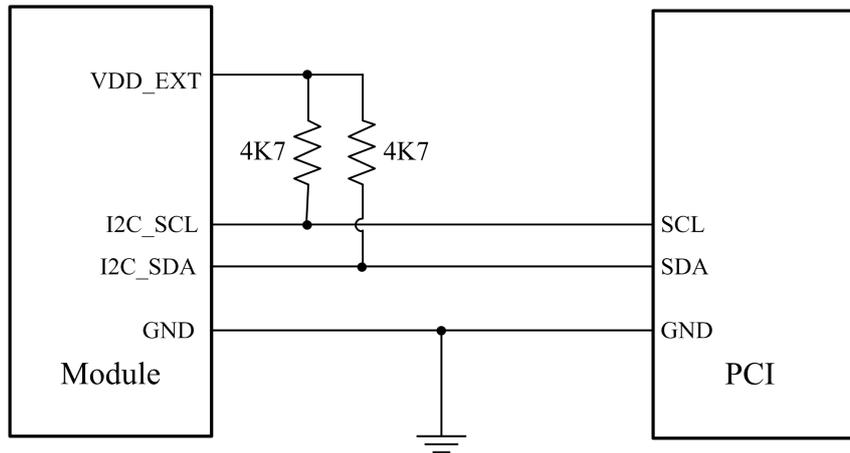


图 3-18 I2C 接口参考电路图

### 3.14 PCM 语音接口

YM310 B09&B19 模块提供一组 PCM 数字音频接口，实现和外部 CODE 或 DAC 音频器件间的通信。

表3-22 PCM管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	描述
30	PCM_CLK	DO	PCM 时钟脉冲
31	PCM_SYNC	DO	PCM 帧同步信号
32	PCM_DIN	DI	PCM 接收数据
33	PCM_DOUT	DO	PCM 发送数据

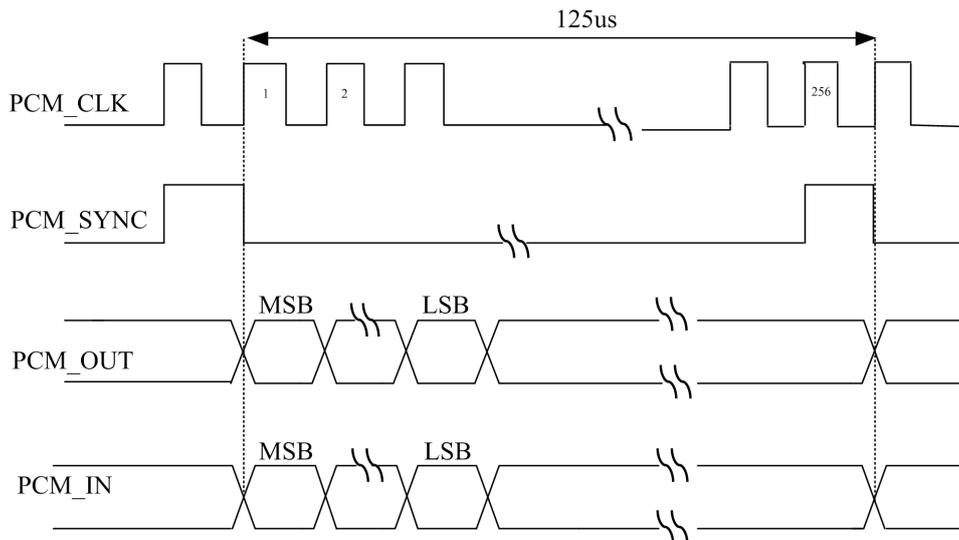


图 3-19 PCM 短帧模式时序图

PCM 转模拟语音推荐电路如下：

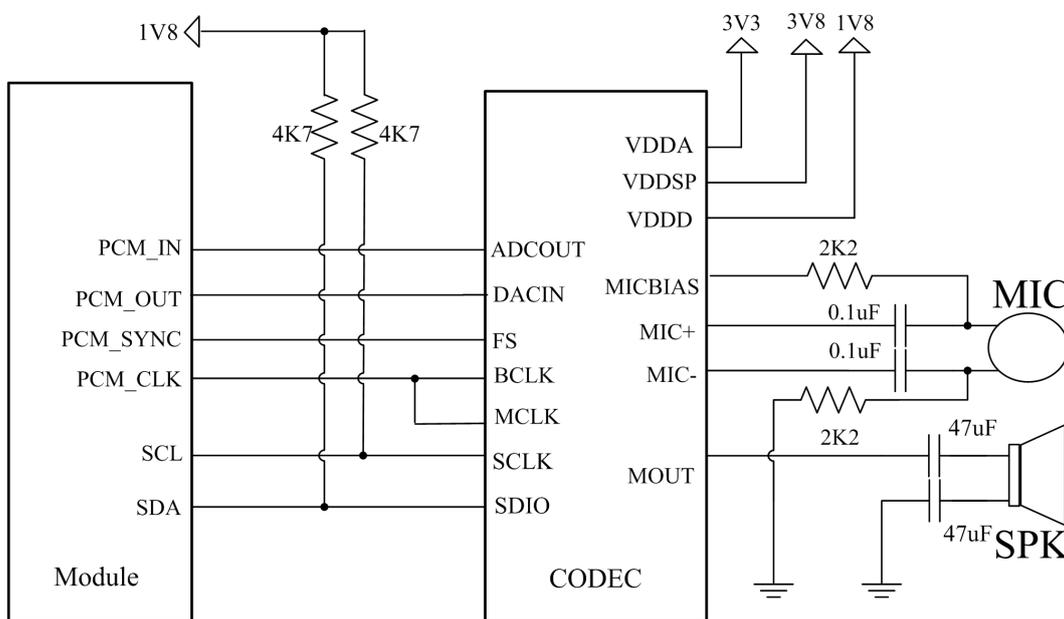


图 3-20 PCM 音频参考电路

### 3.15 模拟语音接口

YM310 B09&B19模块支持一组模拟语音输入通道和输出通道。接口定义如下：

表3-23 AUDIO管脚定义

管脚号	信号名称	I/O	描述	备注
3	MIC_P	AI	麦克风输入+	
4	MIC_N	AI	麦克风输入-	
5	EAR_P	AO	差分音频输出+	听筒接口, 最大输出功率 37mW@THD=1%
6	EAR_N	AO	差分音频输出-	

模拟音频推荐电路如下:

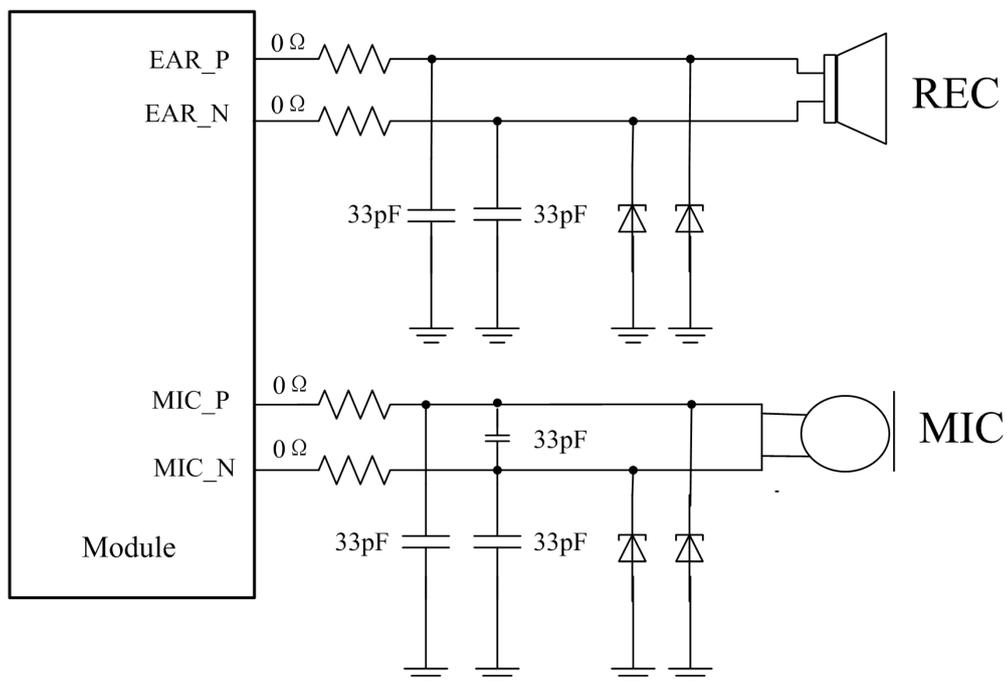


图 3-21 模拟语音电路图

### NOTE

- ✧ EAR\_P/EAR\_N 差分音频输出通道,用于听筒接口。最大输出功率 37mW@THD=1%, R=32Ω。若输出功率无法满足需求,可接外部音频功放器件。
- ✧ 建议采用内置射频滤波双电容(33pF 和 10pF)的驻极体麦克风。
- ✧ 电源和天线尽可能远离音频器件和音频走线。

## 3.16 LCD 接口

YM310 B09&B19 模块部分型号可支持最大分辨率为 320\*240 的 LCD 显示屏。支

持标准的 SPI 4 线单数据传输。

表3-24 LCD接口管脚定义

管脚号	信号名称	I/O	描述	备注
49	LCD_RST	DO	LCD 复位	1.8V 电压域, 不用则悬空
50	LCD_DOUT	DO	SPI 数据信号	
51	LCD_RS	DO	SPI 数据或命令选择	
52	LCD_CS	DO	SPI 从设备片选	
53	LCD_CLK	DO	SPI 时钟信号	
78	LCD_TE	DI	LCD 帧同步	

### 3.17 Camera 接口

YM310 B09&B19 模块部分型号摄像头接口最高支持 300K 像素传感器，支持 SPI 单数据线或双数据线传输。

表3-25 Camera接口管脚定义

管脚号	信号名称	I/O	描述	备注
54	CAM_MCLK	DO	CAM 主时钟	1.8V 电压域
55	CAM_D0	DIO	SPI 数据信号 D0	
56	CAM_D1	DIO	SPI 数据信号 D1	
57	CAM_SCL	OD	CAM 专用 I2C 时钟	需要外部 4.7K 电阻上拉
58	CAM_SDA	OD	CAM 专用 I2C 数据	
80	CAM_CLK	DO	SPI 时钟信号	
81	CAM_PWDN	DO	CAM 下电控制	

### 3.18 矩阵键盘接口

YM310 B09&B19 模块提供一组 5\*5 键盘接口。

表3-26 键盘接口管脚定义

矩阵按键接口				
管脚号	管脚名称	IO	功能描述	备注
74	KP_MKOUT5*	DO	矩阵按键输出 5	1.8V 电压域,功能开发中
75	KP_MKIN5*	DI	矩阵按键输入 5	
76	KP_MKOUT2*	DO	矩阵按键输出 2	

77	KP_MKIN2*	DI	矩阵按键输入 2
82	BOOT/KP_MKOUT4*	DO	矩阵按键输入 4
83	KP_MKIN4*	DI	矩阵按键输入 4
84	KP_MKIN3*	DI	矩阵按键输入 3
85	KP_MKOUT3*	DO	矩阵按键输出 3
86	KP_MKOUT1*	DO	矩阵按键输出 1
87	KP_MKIN1*	DI	矩阵按键输入 1

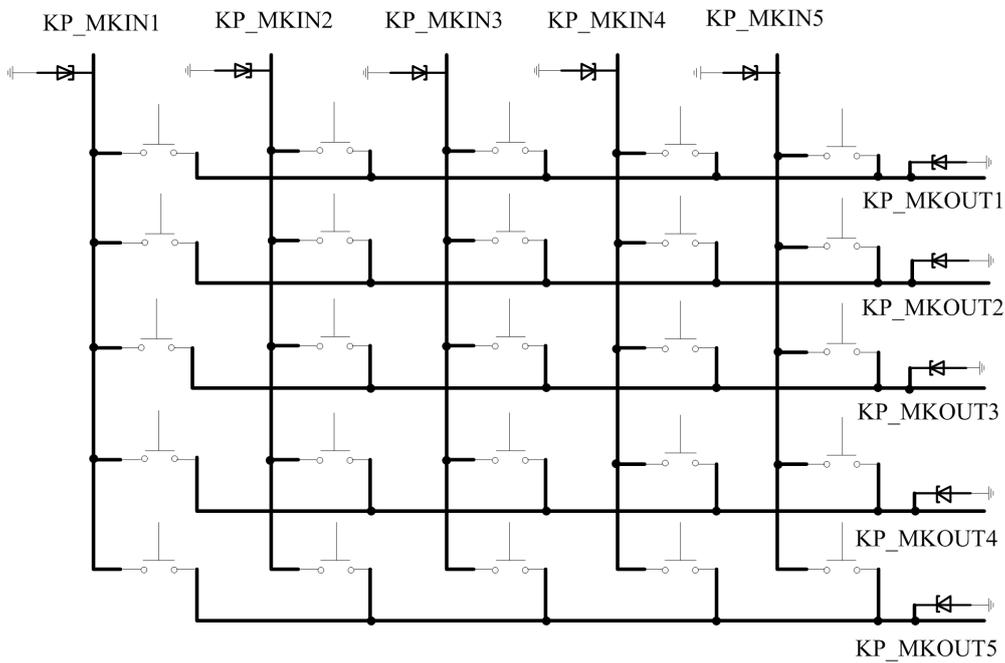


图 3-22 矩阵键盘参考电路

### 3.19 ADC 接口

YM310 B09&B19 模块提供两路模数转换器接口来读取电压值，ADC 接口输入电压不能超过 1.2V，建议 ADC 管脚用分压电路输入。

表3-27 ADC管脚定义

管脚号	信号名称	描述	电平值(V)			备注
			最小值	典型值	最大值	
9	ADC0	模数转换器接口	0		1.2V	12bits 精度
96	ADC1					

## 3.20 射频接口

YM310 B09&B19 模块提供一路 LTE 天线接口，负责模块射频信号的接收和发送。天线接口的特性阻抗均为  $50\ \Omega$ 。

表3-28 天线接口管脚定义

管脚号	信号名称	I/O 属性	描述	备注
35	ANT_MAIN	AIO	LTE 天线接口	$50\ \Omega$ 特性阻抗

### 3.20.1 天线匹配电路

为方便天线调试，天线接口建议在模块信号端口与主板的馈点之间增加  $\pi$  型匹配电路，且走  $50\ \Omega$  阻抗线。

电路如下图：

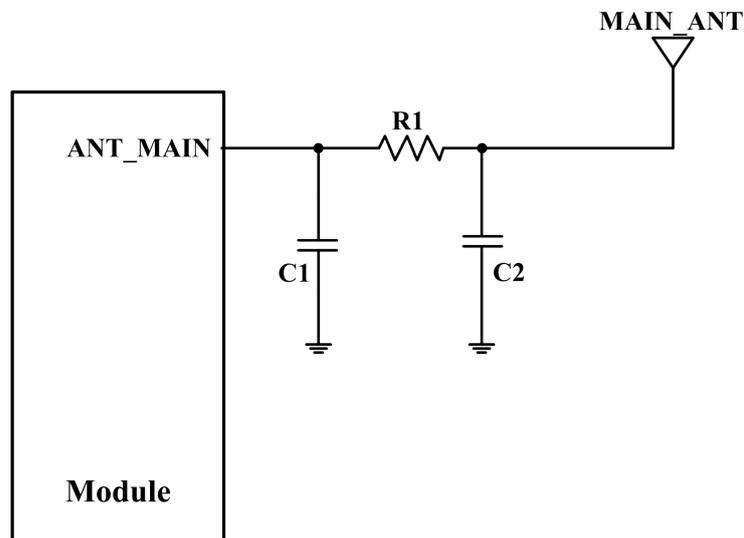


图 3-23 天线匹配电路

#### NOTE

- ✧ YM310 B09&B19 模块的天线接口均为焊盘引出的方式，故设计时需采用与之匹配的射频连接线。
- ✧ 实际设计时用户可根据电路板走线由天线厂调试匹配器件参数值，主板 R1 默认贴  $0$  欧姆，C1/C2 默认空贴。
- ✧ 天线是一个敏感器件，易受外部周围环境的影响，故需要远离数字时钟线，DC 电源等干扰信号，建议使用完整的地层作为参考地。
- ✧ 天线 LAYOUT 走线尽量短，尽可能走直线，避免过孔和翻层，立体包地，并在走线两边多加地孔做隔离。

### 3.20.2 射频走线参考

YM310 B09&B19 模块的天线采用焊盘方式引出，天线焊盘到天线馈点必须使用微带线或其他类型的 RF 走线，信号线的特性阻抗应控制在  $50\Omega$ 。

射频 RF 信号线的阻抗，由材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。因此射频走线需要使用阻抗模拟工具来计算 RF 走线的阻抗值。

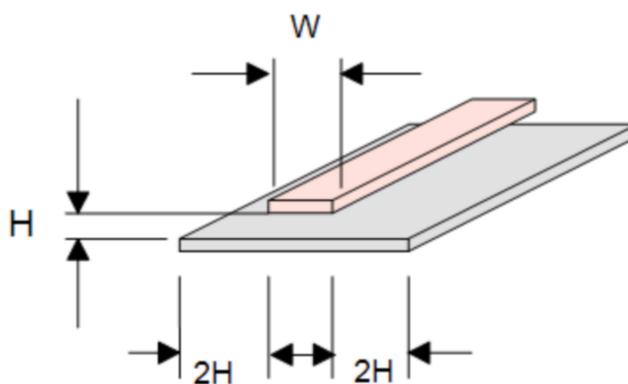


图 3-24 微带线的完整结构

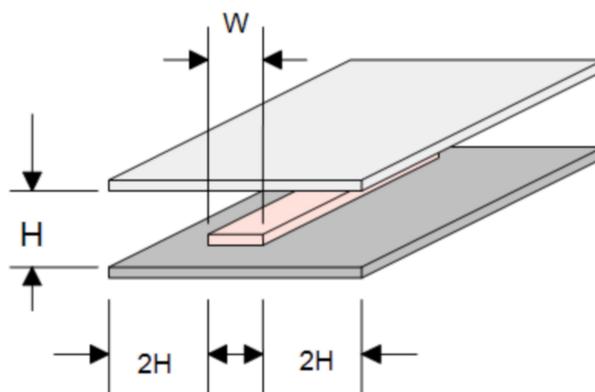


图 3-25 带状线的完整结构

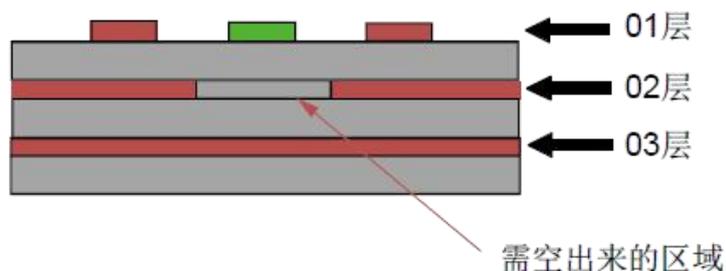


图 3-26 参考地为第三层 PCB 微带传输线结构

## 第 4 章 总体技术指标

### 4.1 本章概述

YM310 B09&B19 模块射频总体技术指标包含以下部分：

- ◇ 工作频率
- ◇ 射频传导测量
- ◇ 传导接收灵敏度和发射功率
- ◇ 天线要求
- ◇ 模块功耗特性

### 4.2 工作频率

表4-1 LTE频率表

频段	上行频率	下行频率	双工模式
LTE B1	1920MHz-1980MHz	2110MHz-2170MHz	FDD
LTE B2	1850MHz-1910MHz	1930MHz-1990MHz	FDD
LTE B3	1710MHz-1785MHz	1805MHz-1880MHz	FDD
LTE B4	1710MHz-1755MHz	2110MHz-2155MHz	FDD
LTE B5	824MHz-849MHz	869MHz-894MHz	FDD
LTE B7	2500MHz - 2570MHz	2620MHz - 2690MHz	FDD
LTE B8	880MHz-915MHz	925MHz-960MHz	FDD
LTE B12	699MHz - 716MHz	729MHz - 746MHz	FDD
LTE B13	777MHz - 787MHz	746MHz - 756MHz	FDD
LTE B17	704MHz - 716MHz	734MHz - 746MHz	FDD
LTE B20	832MHz - 862MHz	791MHz - 821MHz	FDD
LTE B28	703MHz - 748MHz	758MHz - 803MHz	FDD
LTE B66	1710MHz - 1780MHz	2110MHz - 2180MHz	FDD
LTE B34	2010MHz - 2025MHz	2010MHz - 2025MHz	TDD
LTE B38	2570MHz-2620MHz	2570MHz-2620MHz	TDD
LTE B39	1880MHz - 1920MHz	1880MHz - 1920MHz	TDD
LTE B40	2300MHz-2400MHz	2300MHz-2400MHz	TDD
LTE B41	2496MHz-2690MHz	2496MHz-2690MHz	TDD

## 4.3 射频传导测量

### 4.3.1 测试环境

表4-2 测试仪器

测试仪器	电源	村田同轴射频线
R&S CMW500	Agilent 66319	MXHP32HP1000

### 4.3.2 测试标准

YM310 B09&B19 模块通过 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121-1, 3GPP TS 36.521-1, 测试标准。每个模块在工厂均通过严格测试，保证质量可靠。

## 4.4 传导接收灵敏度和发射功率

YM310 B09&B19 模块 LTE 接收灵敏度和发射功率测试指标如下：

表4-3 LTE射频灵敏度指标

名录(灵敏度)	CAT-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 94(10MHz)		-101.2	-100.7
LTE B2(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92(10MHz)		-100.2	-99.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91(10MHz)		-100.7	-100.2
LTE B4(FDD QPSK 通过>95%)	< - 94(10MHz)		-100.2	-99.7
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.5(10MHz)		-100.7	-100.2
LTE B7(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92(10MHz)		-98.2	-97.7
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.5(10MHz)		-101.7	-101.2
LTE B12(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91(10MHz)		-100.2	-100.2
LTE B13(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91(10MHz)		-100.2	-100
LTE B17(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91(10MHz)		-100.7	-100.7
LTE B20(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.5(10MHz)		-100.2	-99.7
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93(10MHz)		-100.7	-100.2
LTE B66(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.5(10MHz)		-99.2	-98.7
LTE B34(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.5(10MHz)		-99.2	-98.7

LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 94.5(10MHz)		-99.7	-99.2
LTE B39(TDD QPSK 通过>95%)	< - 94.5(10MHz)		-99.7	-99.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 94.5(10MHz)		-99.7	-99.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 92.5(10MHz)		-99.7	-99.2

表4-4 LTE射频发射功率指标

名录	3GPP 协议最大 (dBm)	最小	典型	最大
LTE B1	21 to 25	21	23	24
LTE B2	21 to 25	21	23	24
LTE B3	21 to 25	21	23	24
LTE B4	21 to 25	21	23	24
LTE B5	21 to 25	21	23	24
LTE B7	21 to 25	21	23	24
LTE B8	21 to 25	21	23	24
LTE B12	21 to 25	21	23	24
LTE B13	21 to 25	21	23	24
LTE B17	21 to 25	21	23	24
LTE B20	21 to 25	21	23	24
LTE B28	21 to 25	21	23	24
LTE B66	21 to 25	21	23	24
LTE B34	21 to 25	21	23	24
LTE B38	21 to 25	21	23	24
LTE B39	21 to 25	21	23	24
LTE B40	21 to 25	21	23	24
LTE B41	21 to 25	21	23	24

## 4.5 天线要求

YM310 B09&B19 模块天线设计要求:

表4-5 天线指标要求

天线指标	推荐性标准
VSWR	≤2

Gain	>-3 dBi (Avg)
极化类型	垂直极化
输入阻抗	50 $\Omega$
插损<1GHz	< 1 dB
插损 1~2.2GHz	< 1.5 dB
插损 2.3~2.7GHz	< 2 dB

## NOTE

天线性能仅为建议值，客户可根据实际测试结果与认证要求与天线供应商进行评估调整，以便保证终端产品的整体天线性能。

## 4.6 功耗特性

表4-6 休眠空闲功耗

模式	测试条件	电流值 (Avg)	单位
关机漏电	模块关机	120	uA
休眠模式	LTE-FDD @ DRX =0.32S (USB 断开)	1.868	mA
	LTE-FDD @ DRX =0.64S (USB 断开)	1.521	mA
	LTE-FDD @ DRX =1.28S (USB 断开)	1.337	mA
	LTE-FDD @ DRX =2.56S (USB 断开)	1.234	mA
空闲模式	LTE-B1 @ PF = 64 (USB 断开)	13.518	mA
	LTE-B40 @ PF = 64 (USB 断开)	13.527	mA
	LTE-B1 @ PF = 64 (USB 连接)	26.012	mA
	LTE-B40 @ PF = 64 (USB 连接)	26.024	mA

表4-7 LTE数据传输功耗

频段	信道	功率 dBm	电流功耗 mA
LTE-FDD B1 @10Mhz,FRB	18050	21.92	489
	18300	21.9	458
	18550	21.85	502
LTE-FDD B2 @10Mhz,FRB	18650	21.87	462
	18900	21.85	495
	19150	21.86	494

LTE-FDD B3 @10Mhz,FRB	19250	21.8	478
	19575	22.01	457
	19900	21.5	463
LTE-FDD B4 @10Mhz,FRB	20000	22	498
	20175	21.95	481
	20350	21.92	460
LTE-FDD B5 @10Mhz,FRB	20450	22.2	503
	20525	22.17	498
	20600	22.1	503
LTE-FDD B7 @10Mhz,FRB	20800	21.7	520
	21100	21.8	502
	21400	21.78	517
LTE-FDD B8 @10Mhz,FRB	21500	22.3	500
	21625	22.33	496
	21750	22.14	514
LTE-FDD B12 @10Mhz,FRB	23060	22.19	503
	23095	21.96	488
	23130	21.85	488
LTE-FDD B13 @10Mhz,FRB	-	-	-
	23230	22.1	489
	-	-	-
LTE-FDD B17 @10Mhz,FRB	23780	21.9	486
	23790	22.08	494
	23800	22	493
LTE-FDD B20 @10Mhz,FRB	24200	22.4	514
	24300	22.16	475
	24400	22.02	480
LTE-FDD B28 @10Mhz,FRB	27260	22.17	510
	27435	22.16	491
	27610	22.2	489
LTE-FDD B66	132022	21.78	499

@10Mhz,FRB	132322	22.1	464
	132622	21.53	481
LTE-TDD B34 @10Mhz,FRB	36250	21.8	255
	36275	21.82	255
	36300	21.7	257
LTE-TDD B38 @10Mhz,FRB	37800	21.9	266
	38000	21.9	268
	38200	22	272
LTE-TDD B39 @10Mhz,FRB	38300	21.86	251
	38450	21.8	252
	38600	21.9	252
LTE-TDD B40 @10Mhz,FRB	38700	21.9	252
	39150	21.8	252
	39600	21.9	256
LTE-TDD B41 @10Mhz,FRB	39700	22	270
	40620	21.97	266
	41540	21.9	285

## 第 5 章 接口电气特性

### 5.1 本章概述

- ◇ 工作存储温度
- ◇ 模块 IO 电平
- ◇ 电源电压
- ◇ 静电特性
- ◇ 可靠性指标

### 5.2 工作存储温度

表5-1 YM310 B09&amp;B19模块工作存储温度

参数	最小值	最大值
正常工作温度	-30℃	75℃
极限工作温度	-40℃	85℃
存储温度	-40℃	90℃

### 5.3 模块IO电平

YM310 B09&B19 模块 IO 电平如下：

表5-2 YM310 B09&amp;B19模块电气特性

参数	参数描述	最小值	最大值
VIH	输入逻辑高电平电压	$0.65 * VDD\_EXT$	$VDD\_EXT + 0.3V$
VIL	输入逻辑低电平电压	-	$0.35 * VDD\_EXT$
VOH	输出逻辑高电平电压	$VDD\_EXT - 0.45V$	$VDD\_EXT$
VOL	输出逻辑低电平电压	0	0.45V

### 5.4 电源特性

YM310 B09&B19 模块输入供电电源要求如下：

表5-3 YM310 B09&amp;B19模块工作电压

参数	最小值	典型值	最大值
VBAT	3.3V	3.7V	4.2V

## NOTE

✧ 模块任何接口的上电时间不得早于模块的开机时间，否则可能导致模块异常或损坏。

## 5.5 静电特性

YM310 B09&B19 模块内部设计时已经考虑并做了相应的 ESD 防护，但在模块的生产组装和实验测试中也有可能发生 ESD 问题，所以应用开发者需考虑最终产品的 ESD 防护。

客户设计时除了参考文档接口设计的推荐电路外，也需要注意以下几点：

- ✧ 防护器件 PCB 布线应尽量走“45 度或 135 度”形线，避免走“T”形线。
- ✧ 模块周边地平面保证完整性，不要进行分割。
- ✧ 在模块的生产、组装和实验室测试过程中需要关注周边环境和操作人员的 ESD 管控。

表5-4 YM310 B09&B19 ESD特性

测试端口	接触放电	空气放电	单位
VBAT 电源	±4	±8	KV
天线接口	±4	±8	KV
其他接口	±0.5	±1	KV

## 5.6 可靠性指标

表5-5 YM310 B09&B19 可靠性测试

测试项目	测试条件	参考标准	测试结果
低温工作	温度：-40℃ 工作模式：正常工作 测试持续时间：24h	IEC60068-2-1	外观检查：正常 功能检查：正常
高温工作	温度：85℃ 工作模式：正常工作 测试持续时间：24h	JESD22-A108-C	外观检查：正常 功能检查：正常
温度循环	高温温度：85℃ 低温温度：-40℃	JESD22-A105-B	外观检查：正常 功能检查：正常

	<p>工作模式：正常工作</p> <p>测试持续时间：30cycles； 1h+1h/cycle</p>		
交变湿热	<p>高温温度：55℃</p> <p>低温温度：25℃</p> <p>湿度：95%±3%</p> <p>工作模式：正常工作</p> <p>测试持续时间：6 cycles； 12h+12h/cycle</p>	JESD22-A101-B	<p>外观检查：正常</p> <p>功能检查：正常</p> <p>射频指标检查：正常</p>
温度冲击	<p>高温温度：85℃</p> <p>低温温度：-40℃</p> <p>温度变更时间：&lt;30s</p> <p>工作模式：无包装，无上电，不开机</p> <p>测试持续时间：100 cycles； 15min+15min/cycle</p>	JESD22-A106-B	<p>外观检查：正常</p> <p>功能检查：正常</p>
跌落测试	<p>高度 0.8m，6 面各一次，跌落到水平大理石平台</p> <p>工作模式：无包装，无上电，不开机</p>	IEC60068-2-32	<p>外观检查：正常</p> <p>功能检查：正常</p> <p>射频指标检查：正常</p>
低温存储	<p>温度：-40℃</p> <p>工作模式：无包装，无上电，不开机</p> <p>测试持续时间：24 h</p>	JESD22-A119-C	<p>外观检查：正常</p> <p>功能检查：正常</p>
高温存储	<p>温度：85℃</p> <p>工作模式：无包装，无上电，不开机</p> <p>测试持续时间：24h</p>	JESD22-A103-C	<p>外观检查：正常</p> <p>功能检查：正常</p>

## 第 6 章 结构及机械特性

### 6.1 本章概述

- ◇ 外观
- ◇ 模块机械尺寸

### 6.2 外观

YM310 B09&B19 模块为单面布局的 PCBA，外观图如下所示：



图 6-1 YM310 B09&B19 外观图

### 6.3 机械尺寸

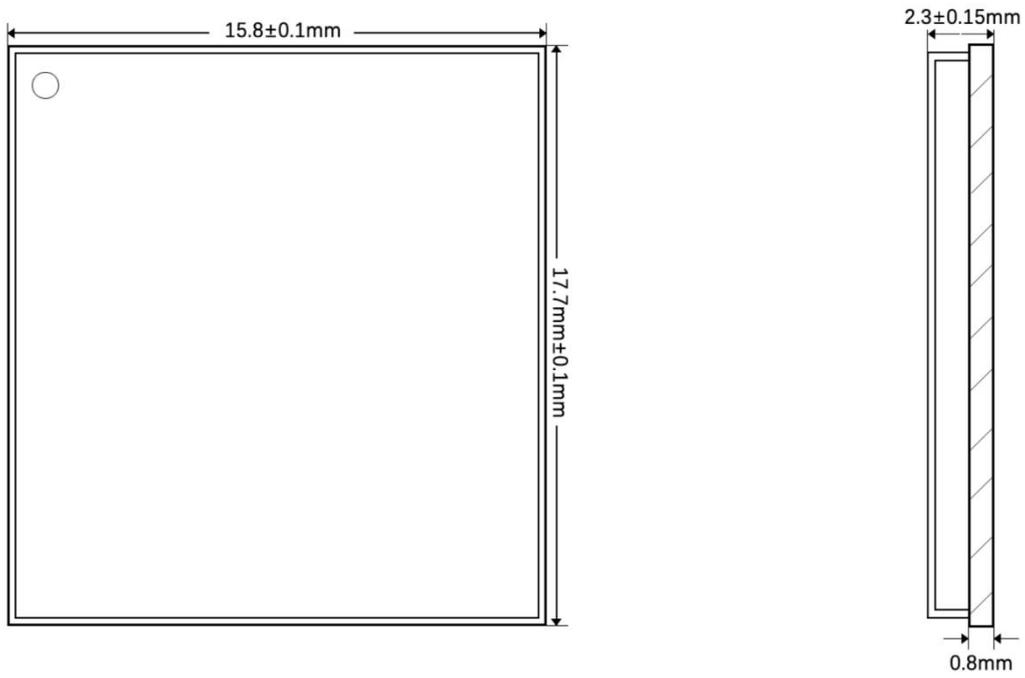


图 6-2 模块正视图与侧视图(单位：毫米)

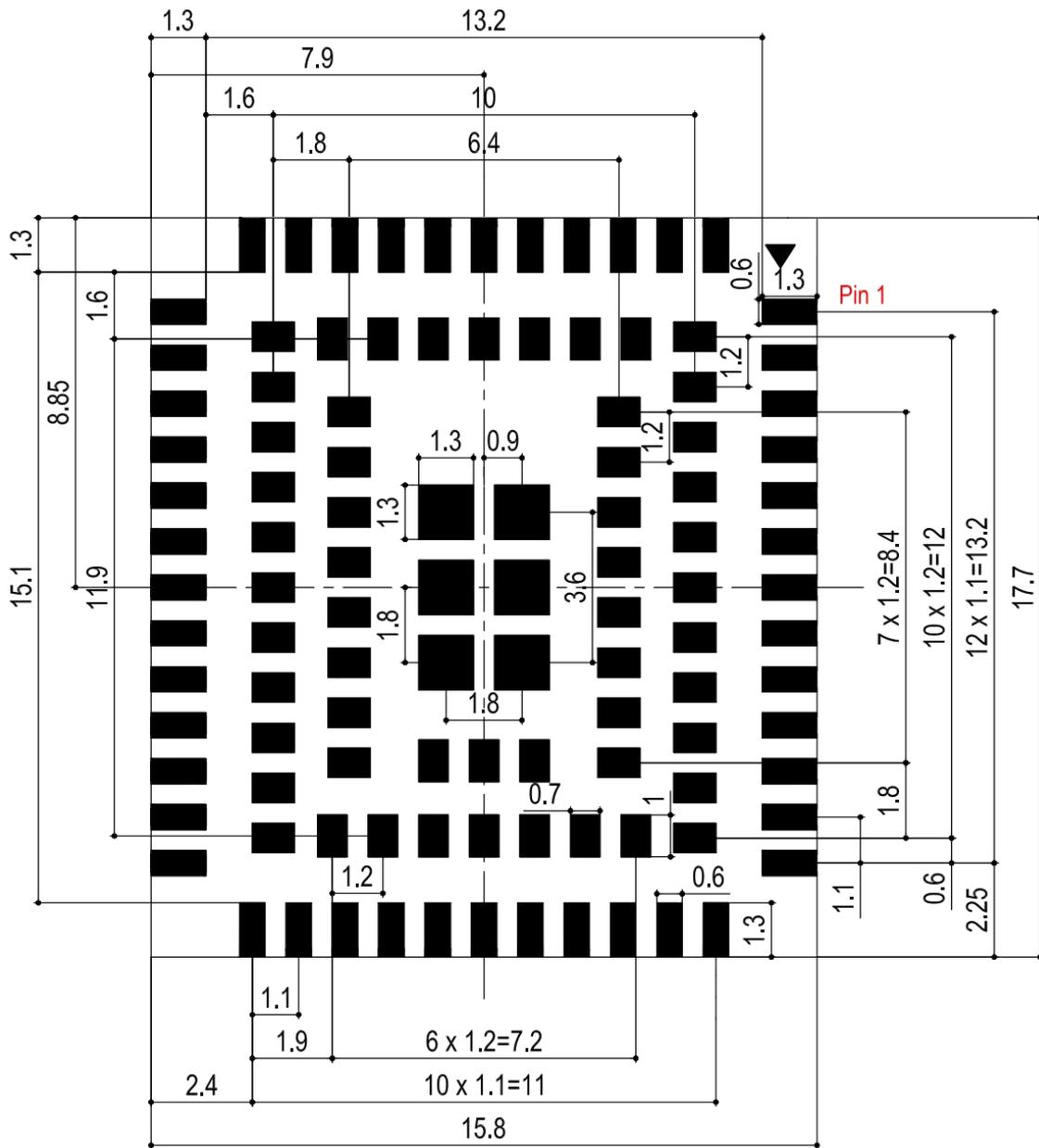


图 6-3 模块底视图（单位：毫米）

模块推荐封装:

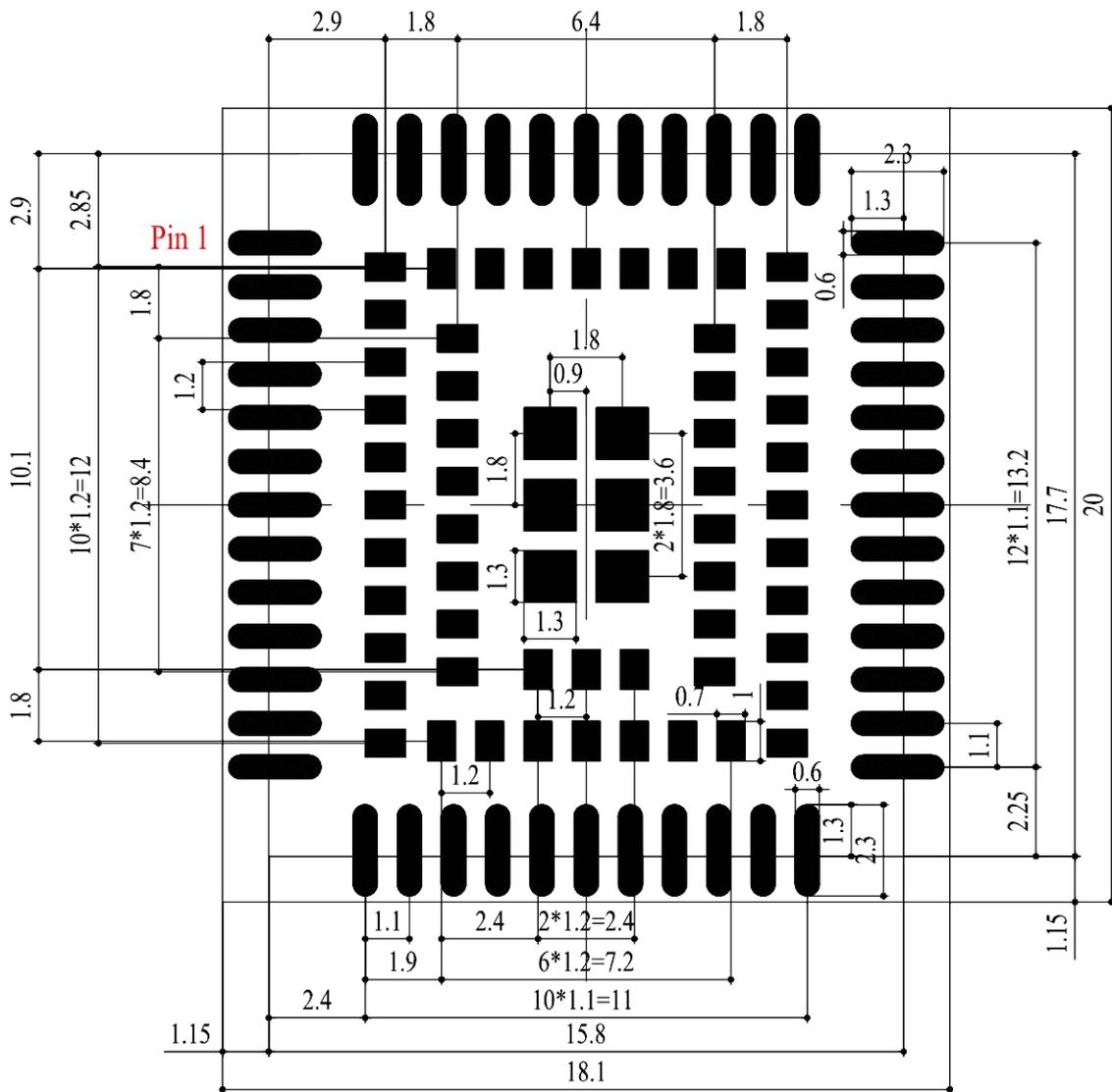


图 6-4 模块推荐封装(单位: 毫米)

## 第 7 章 包装与生产

### 7.1 本章概述

- ◇ 模块包装与存储
- ◇ 生产焊接

### 7.2 模块包装与存储

YM310 B09&B19 模块用编带包装，以 1000PCS 为一盘，每盘以真空密封袋的形式出货。

YM310 B09&B19 模块的存储需遵循如下条件：

- ◇ 模块的潮湿敏感等级为 3 级。
- ◇ 环境温度小于 40 摄氏度，空气湿度小于 90%情况下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
- ◇ 当真空密封袋打开后，若满足模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，工厂在 72 小时以内完成贴片,模块可直接进行回流焊或其它高温流程。
- ◇ 若模块处于其他条件，需要在贴片前进行烘烤。
- ◇ 如果模块需要烘烤，移除模块包装后请在 125 摄氏度下(允许上下 5 摄氏度的波动)烘烤 8 小时。

### 7.3 生产焊接

YM310 B09&B19 模块使用编带包装，SMT 线体需配置 32mm 载料器；

- ◇ 为保证模块印膏质量，YM310 B09&B19 模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.15mm~0.2mm。
- ◇ 推荐回流焊的温度为 235~246°C，不能超过 246°C。
- ◇ 建议使用无铅工艺，模块最大回流次数为 1 次。
- ◇ PCB 双面布局时，LGA 模块布局必须在第 2 面加工。避免因模块重力导致翻转回流时造成模块掉件、焊接开焊及模块内部焊接不良等。
- ◇ 模块焊接后，使用 X-ray 和光学检验方法检验焊接质量，具体请参照《IPC-A-610H》相关标准。

下图所示的只是一般推荐的焊接炉温曲线，应根据具体应用和制造限制进行调整。

推荐的炉温曲线图如下图所示：

推荐的炉温曲线图如下图所示：

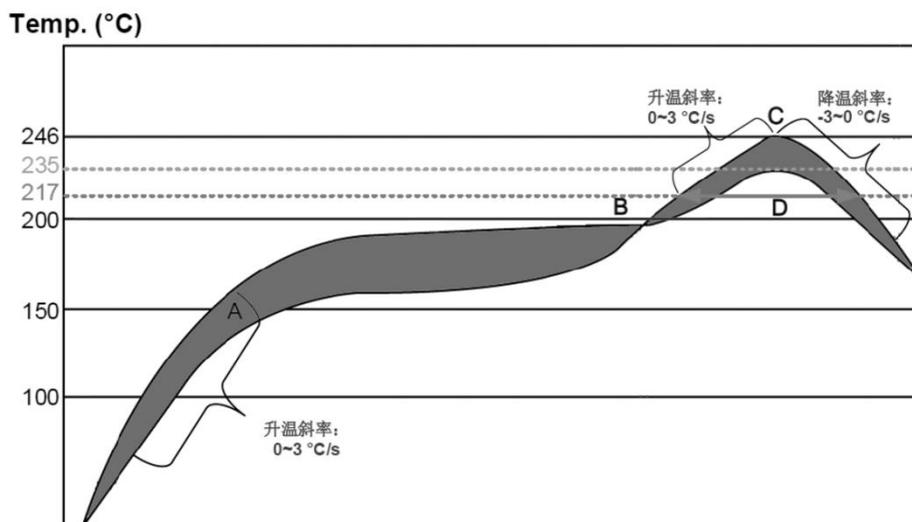


图 7-1 回流焊温度曲线图

表7-1 回流工艺参数表

温区	时间	关键参数
预热区(室温到 150°C)	NA	升温斜率：0°C/s~3°C/s
均温区(A 到 B 期间 150°C~200°C)	70s~120s	
回流区(D:>217°C 期间)	40s~60s	峰值温度：235°C~246°C
冷却区	NA	降温斜率：-3°C/s~0°C/s

## 第 8 章 附录

### 8.1 本章概述

- ◇ 缩略语
- ◇ 编码方式
- ◇ 使用安全与注意事项

### 8.2 缩略语

表8-1 术语缩写

缩略语	全称
3GPP	Third Generation Partnership Project
AP	Access Point
AMR	Adaptive Multi-rate
BER	Bit Error Rate
CCC	China Compulsory Certification
CDMA	Code Division Multiple Access
CE	European Conformity
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DC	Direct Current
DTR	Data Terminal Ready
DL	Down Link
DTE	Data Terminal Equipment
EU	European Union
EMC	Electromagnetic Compatibility
ESD	Electrostatic Discharge
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access
HSPA	Enhanced High Speed Packet Access
HSUPA	High Speed Up-link Packet Access
IMEI	International Mobile Equipment Identity
LED	Light-Emitting Diode

LTE	Long Term Evolution
NC	Not Connected
PCB	Printed Circuit Board
PCM	Pulse Code Modulation
PDU	Protocol Data Unit
PMU	Power Management Unit
PPP	Point-to-point protocol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RF	Radio Frequency
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
SMS	Short Message Service
TIS	Total Isotropic Sensitivity
TVS	Transient Voltage Suppressor
TX	Transmitting Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
USIM	Universal Subscriber Identity Module
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access
WWAN	Wireless Wide Area Network

### 8.3 编码方式

表8-2 GPRS/EDGE不同等级的时隙分配表

Slot class	DL slot number	UL slot number	Active slot number
1	1	1	2
2	2	1	3
3	2	2	3
4	3	1	4
5	2	2	4
6	3	2	4

7	3	3	4
8	4	1	5
9	3	2	5
10	4	2	5
11	4	3	5
12	4	4	5

表8-3 GPRS最大速率

GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)	Modulation type
CS 1 = 9.05 kb/s / time slot	36.2 kb/s	GMSK
CS 2 = 13.4 kb/s / time slot	53.6 kb/s	GMSK
CS 3 = 15.6 kb/s / time slot	62.4 kb/s	GMSK
CS 4 = 21.4 kb/s / time slot	85.6 kb/s	GMSK

表8-4 EDGE最大速率

GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)	Modulation type
MCS 1 = 8.8 kb/s/ time slot	35.2 kb/s	GMSK
MCS 2 = 11.2 kb/s/ time slot	44.8 kb/s	GMSK
MCS 3 = 14.8 kb/s/ time slot	59.2 kb/s	GMSK
MCS 4 = 17.6 kb/s/ time slot	70.4 kb/s	GMSK
MCS 5 = 22.4 kb/s/ time slot	89.6 kb/s	8PSK
MCS 6 = 29.6 kb/s/ time slot	118.4 kb/s	8PSK
MCS 7 = 44.8 kb/s/ time slot	179.2 kb/s	8PSK
MCS 8 = 54.4 kb/s/ time slot	217.6 kb/s	8PSK
MCS 9 = 59.2 kb/s/ time slot	236.8 kb/s	8PSK

表8-5 LTE-FDD DL最大速率

LTE-FDD device category	Max data rate(peak)	Modulation type
Category 1	10Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 2	50Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 3	100Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 4	150Mbps	QPSK/16QAM/64QAM

表8-6 LTE-FDD UL最大速率

LTE-FDD device category	Max data rate(peak)	Modulation type
Category 1	5Mbps	QPSK/16QAM
Category 2	25Mbps	QPSK/16QAM
Category 3	50Mbps	QPSK/16QAM
Category 4	50Mbps	QPSK/16QAM

## 8.4 使用安全与注意事项

为了安全的使用无线设备，请终端设备告知用户相关安全信息：

- ◇ 干扰：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全时，请关闭无线设备。因为终端在开机的状态时会收发射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电器设备时会对其产生干扰。
- ◇ 医疗设备：在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定，并关闭本设备。某些无线设备可能会干扰医疗设备，导致医疗设备不能正常工作，或导致误差，如果发生干扰，请关闭无线设备，并咨询医生。
- ◇ 易燃易爆区域：在易燃易爆区域，请关闭您的无线设备，并遵守相关标识说明，以免引起爆炸或火灾。如：加油站、燃料区、化工制品区域以及化工运输及存储设施，有爆炸危险标志的区域，有“关掉无线电设备”标志的区域等。
- ◇ 交通安全：请遵守所在国家或地区的当地法律或法规关于在驾驶车辆时对无线设备使用的相关规定。
- ◇ 航空安全：乘坐飞机时，请遵守航空公司关于无线设备使用的相关规定和条例。在起飞前，请关闭无线设备，以免无线信号干扰飞机控制信号。
- ◇ 环境保护：请遵守有关设备包装材料、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。
- ◇ 紧急呼叫：本设备使用无线信号进行传播。因此不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本无线设备作为唯一的联系方式。